

FED

Fachverband für Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Regionalgruppenrundreise 2018 – 1. Etappe

13.03.2018 Nürnberg

14.03.2018 Jena

15.03.2018 Dresden

VISCOM
vision technology

Viscom AG



Viscom AG

Röntgentest, eine zerstörungsfreie Analysemethode

Referent: Michael Mügge, Vertriebsingenieur der Viscom AG



Inhalt

- Die Herausforderung
- Anwendungsbeispiele AOI/AXI
- Vergleich AOI/AXI
- Wirtschaftliche Betrachtungen
- Zusammenfassung

Viscom im Überblick

- Europäischer Marktführer in der Lötstellen-Inspektion, Schwerpunkt in der Automobilelektronik
- Gründung 1984 in Hannover
- Konzern-Umsatz 2016: 77.245 T €
- Prognose 2017: Umsatz 80 - 85 Mio. €
- 382 Mitarbeiter zum Jahresende 2016
- Weltweit durch Niederlassungen, Support- und Servicestützpunkte vertreten
- Dichtes Repräsentanten-Netzwerk



33 Jahre!

Viscom AG - ad hoc Meldung vom 05.03.2018

Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG

Viscom AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG

05.03.2018 / 09:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG

Hannover, 5. März 2018 - Volker Pape, Vorstand und Mitbegründer der Viscom AG, hat seinen Wunsch erklärt, vor der diesjährigen Hauptversammlung seine Vorstandstätigkeit niederzulegen und auf Vorschlag der Mehrheitsgesellschafterin HPC Vermögensverwaltung GmbH in den Aufsichtsrat der Viscom AG zu wechseln. Volker Pape wird dem Unternehmen auch im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung künftig beratend zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat begrüßt diesen Schritt im Sinne einer langfristigen Nachfolgeplanung und sieht damit die weitere Expansion und die damit einhergehende Ausweitung des internationalen Geschäfts als gewährleistet an.

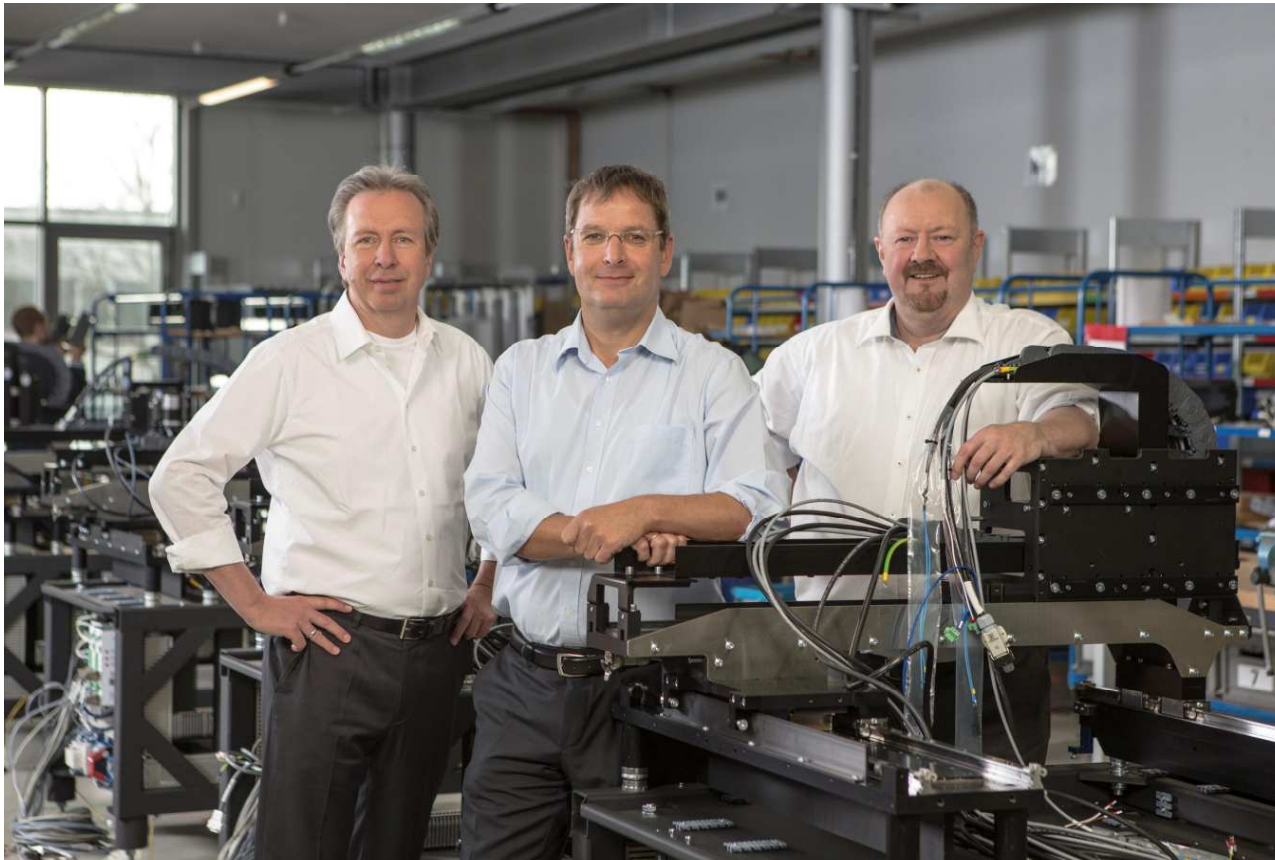
Der zukünftige Vorstand soll in diesem Zuge auf vier Personen erweitert werden. Der Aufsichtsrat hat zur Nachfolge von Herrn Pape die beiden langjährigen Mitarbeiter Peter Krippner und Carsten Salewski zu Vorständen berufen. Beide haben große Führungsverantwortung als Bereichs- und Niederlassungsleiter erworben. Herr Salewski wird dabei in Zukunft den Bereich Vertrieb und Herr Krippner das Ressort Operations verantworten. Herr Dr. Heuser übernimmt den Bereich Entwicklung und Herr Schwingel ist weiterhin für das Ressort Finanzen verantwortlich.

Im Zusammenhang mit der angestrebten Erweiterung und personellen Neuaufstellung im Vorstand der Viscom AG haben die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Hackmann und Klaus Friedland mitgeteilt, ihre Mandate mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 30. Mai 2018 in Hannover stattfinden wird, niederzulegen, um auch im Aufsichtsrat einen personellen Neuanfang zu ermöglichen. Der Aufsichtsrat wird den Wahlvorschlag der HPC Vermögensverwaltung GmbH nach § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AktG prüfen. Darüber hinaus finden Gespräche mit potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten für das weitere vakant werdende Aufsichtsratsmandat statt.

Kontakt:
Viscom AG
Investor Relations
Anna Borkowski
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-861
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de

Viscom – Erstklassig und verlässlich

Erstklassig: Erfahrung und Innovationskraft seit über 33 Jahren



Viscom Vorstände Dr. Martin Heuser, Dirk Schwingel und Volker Pape



*Peter Krippner, Leiter des
Geschäftsbereichs SP
Serienprodukte*

Viscom Zentrale am Standort in Hannover

Inspektionssysteme „made in Germany“

Zentrale (2001)

- Verwaltung, Vertrieb
- Projektmanagement
- Nutzfläche 2.400 m²

Produktionsgebäude F2 (1999)

- Verpackung und Versand
- Nutzfläche 600 m²

Produktionsgebäude F1 (1998)

- Inbetriebnahme
- Testabläufe
- Nutzfläche 800 m²

Entwicklungszentrum (1992)

- F&E
- Software
- Nutzfläche 1.400 m²

Neubau (2016)

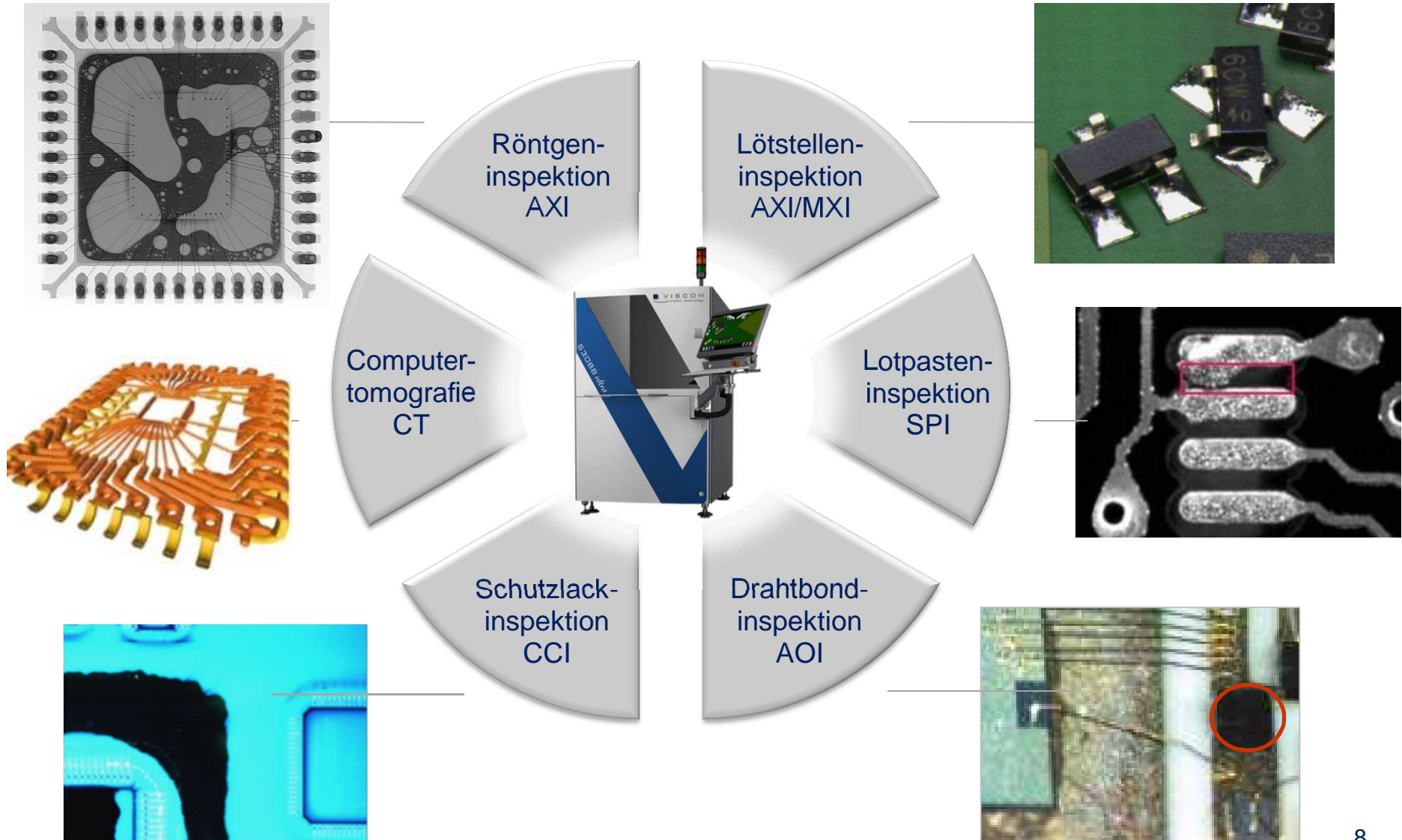
- Büros, Demo- und Schulungcenter
- Storage area
- Area: ~ 6.000 m²

Produktionsgebäude F3/F4 (F3: 2002, F4: 2005)

- Lager, Produktion
- Produktionsleitung
- Schulung
- Nutzfläche 6.700 m²

Quelle: Google Earth

Inspektionslösungen für die Elektronikindustrie



1. Einleitung – Definition Röntgen

Was ist Röntgen?

Definition:

Röntgen, benannt nach dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (27.03.1845 - 10.02.1923) ist ein weit verbreitetes bildgebendes Verfahren, bei dem ein „Körper“ unter Verwendung eines Röntgenstrahlers durchstrahlt wird.

Die Durchdringung des Körpers mit Röntgenstrahlen wird in Bildern dargestellt, die als Röntgenbilder, Röntgenaufnahmen oder Radiographien bezeichnet werden.

Röntgen bedeutet demnach:

- Durchleuten von Materie
- Verdecktes sichtbar machen

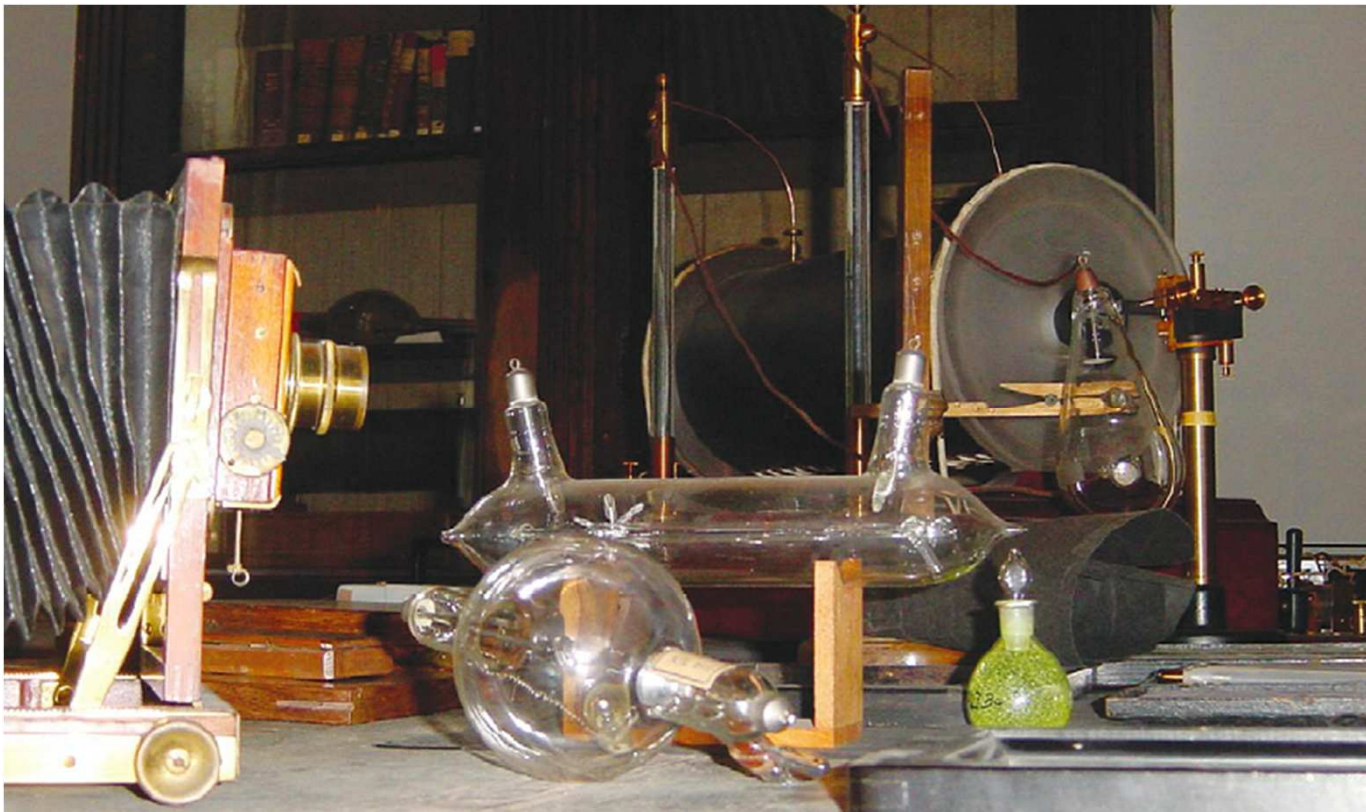


Quelle: www.wikipedia.de

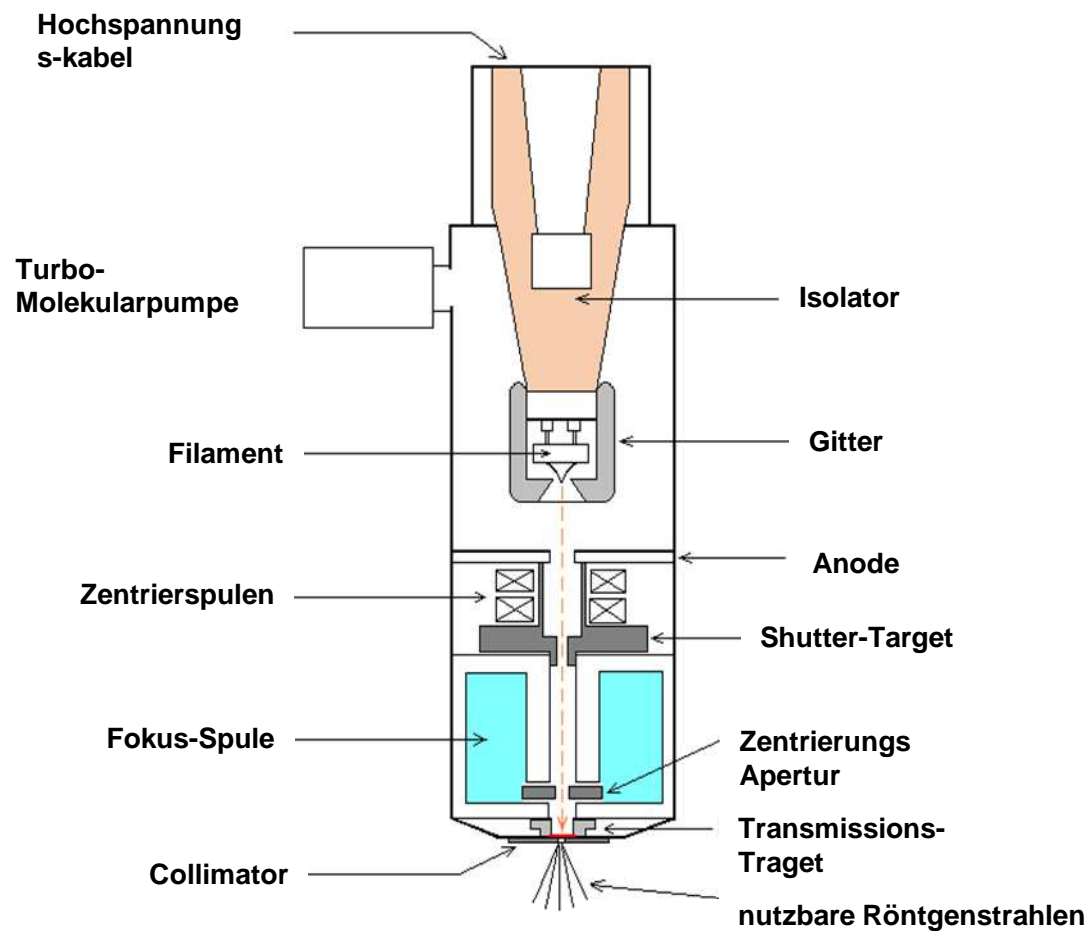
Im ehemaligen Physikalischen Institut der Universität Würzburg – heute Hochschule Würzburg-Schweinfurt – entdeckte Prof. Dr. Wilhelm Conrad Röntgen am späten Freitagabend des 8. November 1895 – wie er selbst sagte „als sich keine dienstbaren Geister mehr im Hause befanden“ diese sensationelle Strahlen, denen er den Namen X-Strahlen gab.



Conrad Röntgen untersuchte 1895 im Physikalischen Institut der Universität Würzburg die Eigenschaften von Hochspannungsfeldern in entlüfteten Glaskolben und entdeckte dabei zufällig die später nach ihm benannten „X-Strahlen“

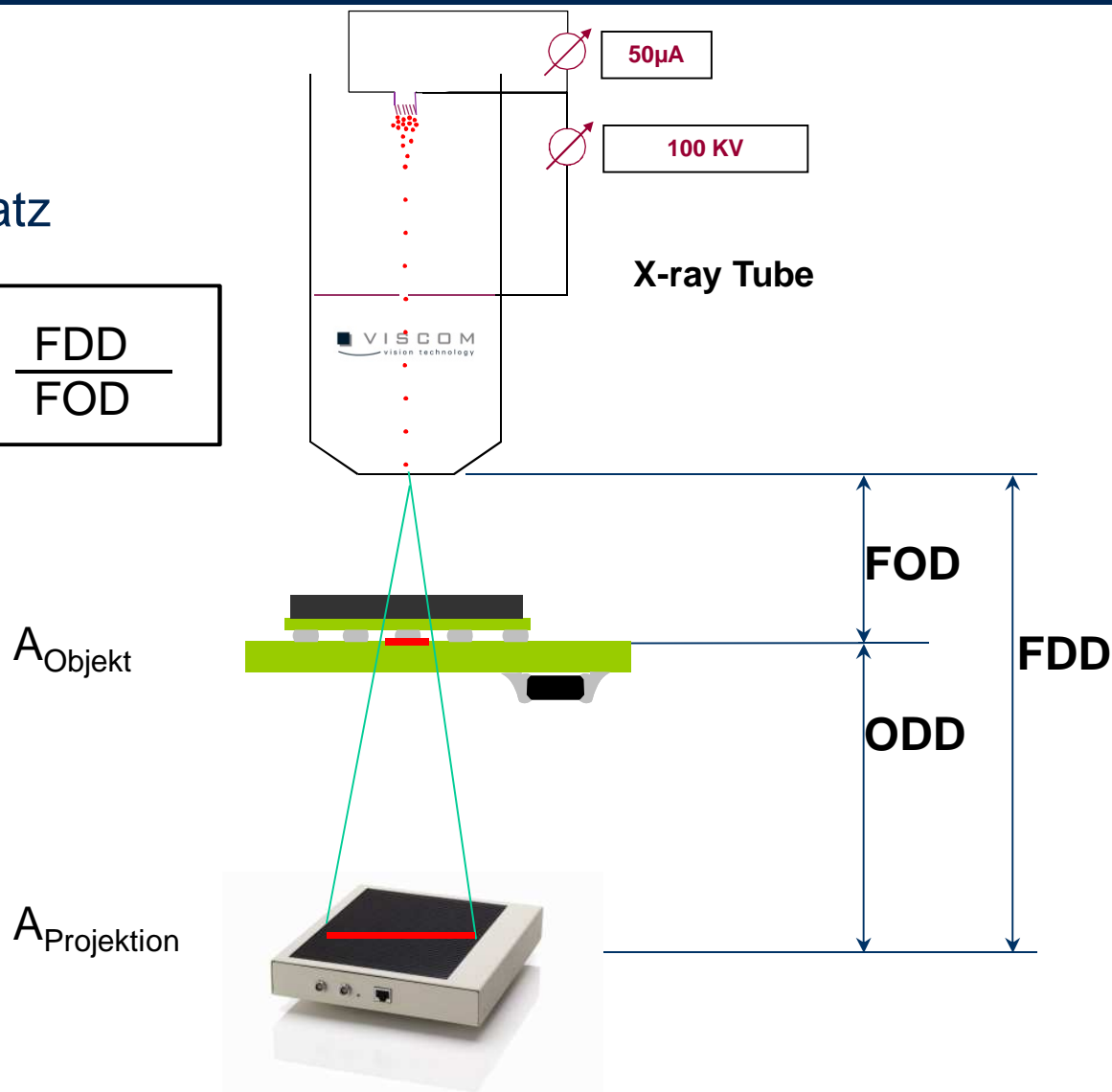


Open Transmission Radiator Tube - Offene Transmissionsröhre

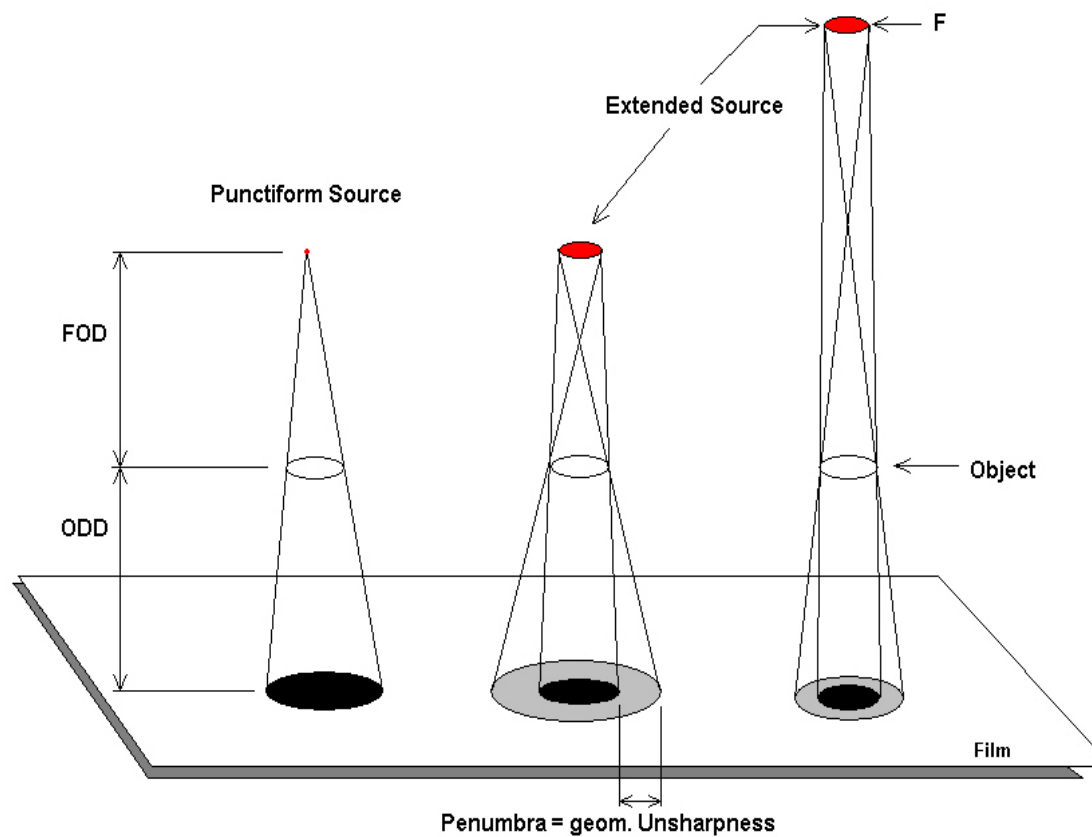


Die Vergrößerung
 ergibt sich
 aus dem Strahlensatz

$$A_{\text{Projektion}} = A_{\text{Objekt}} \times \frac{\text{FDD}}{\text{FOD}}$$



Bildschärfe



Die Schärfe des Röntgenbildes wird beeinflusst von

- ... dem Durchmesser des Fokuspunktes auf dem Target
- ... dem Abstand zwischen Fokuspunkt, Objekt und Röntgendetektor

Erlangung einer Betriebsgenehmigung für Röntengeräte

1. Ausbildung mindestens eines Mitarbeiters aus dem das Röntgensystem betreibenden Unternehmen zum Strahlenschutzbeauftragten.

Die mehrtägigen Kurse vermitteln die Fachkunde im Strahlenschutz. Abhängig von der abgeschlossenen technisch-wissenschaftlichen Berufsausbildung wird eine in mehreren Monaten erworbene Sachkunde in der vorgesehenen Tätigkeit gefordert. Diese muss ggf. nach Beendigung des Kurses vor Aufnahme der verantwortlichen Tätigkeit erworben werden. Einzelheiten dazu findet man in der Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenverordnung (RöV). Für die wie Vollschutzgeräte, jedoch ohne Bauartzulassung, ausgelegten Viscom-Systeme ist mindestens ein Strahlenschutzkurs gemäß Tätigkeitsgruppe R3 der RöV zu absolvieren. Manche Aufsichtsbehörden setzen jedoch einen Kurs nach Tätigkeitsgruppe R1.1 oder R5.1 für die Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten voraus. Es empfiehlt sich in jedem Fall, vor Aufnahme des Strahlbetriebes Rücksprache mit der zuständigen Gewerbeaufsichtsbehörde zu halten, um die konkreten Erfordernisse zu erfragen. Der Betreiber des Systems hat hier rechtlich eine Bringschuld.

Erlangung einer Betriebsgenehmigung für Röntengeräte

2. Strahlenschutzverantwortlicher des das Röntgensystem betreibenden Unternehmens ist der (technische) Unternehmensleiter/Inhaber/Geschäftsführer. Sofern dieser nicht selbst die Fachkunde erlangen und die Strahlenschutzaufgaben im Rahmen des Anlagenbetriebes wahrnehmen will, muss er einen fachkundigen Strahlenschutzbeauftragten dafür bestellen und dessen Befugnisse und Entscheidungsbereiche festlegen. Diese Bestellung muss der Genehmigungsbehörde schriftlich angezeigt werden, teilweise stellt die Behörde Formblätter zur Verfügung.
3. Zweckmäßigerweise wird eine Genehmigung zum Betrieb der Röntgenanlage einige Tage vor deren Installation und Inbetriebnahme bei der zuständigen Behörde beantragt. Dieses kann formlos erfolgen, sollte jedoch eine Beschreibung des Gerätes mit den wichtigsten technischen Daten enthalten. Die Zuständigkeiten können landesunterschiedlich bei den Gewerbeaufsichtsämtern oder z. B. beim Landesamt für Arbeitssicherheit liegen.

Erlangung einer Betriebsgenehmigung für Röntengeräte

4. Ebenso muss frühzeitig ein Auftrag an eine Sachverständigenstelle zur Prüfung der Anlage gemäß Röntgenverordnung erteilt werden. Typische Gutachterinstitutionen sind die technischen Überwachungsvereine oder auch z. B. Landesämter für Umwelt- und Immissionsschutz. Dieser Abnahmetermin sollte am oder kurz nach dem Installationstag des Systems stattfinden und kann der Genehmigungsbehörde mit dem Genehmigungsantrag vorab angekündigt werden. Für eine behördliche Betriebsgenehmigung ist grundsätzlich die Vorlage des technischen Gutachtens Voraussetzung.
5. Die RöV schreibt die Wiederholungsprüfung durch einen Sachverständigen bei Aufstellungsort-Änderungen (auch innerhalb eines Raumes) und unabhängig von Änderungen in Abständen von maximal 5 Jahren sowie eine jährliche Unterweisung des Bedienpersonals des Röntgensystems über Arbeitsmethoden, mögliche Gefahren und Schutzmaßnahmen vor. Diese Unterweisungen gehören i. A. zu den Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten. Eine Überwachung der Exposition des Personals mittels Personendosimetrie ist bei Vollschutz- oder vergleichbaren Geräten nicht vorgeschrieben. Die Geräteabschirmung verhindert bei diesen Geräten eine unzulässige Strahlenbelastung von Personen.

In der guten alten Zeit ...

Eine elektrische Baugruppe der Sachsenwerk Licht und Kraft AG um 1932
Resitex oder Pertinax-Leiterplatten, diskrete Bauteile verbunden mit Nietlötösen



Moderne Baugruppenmontage

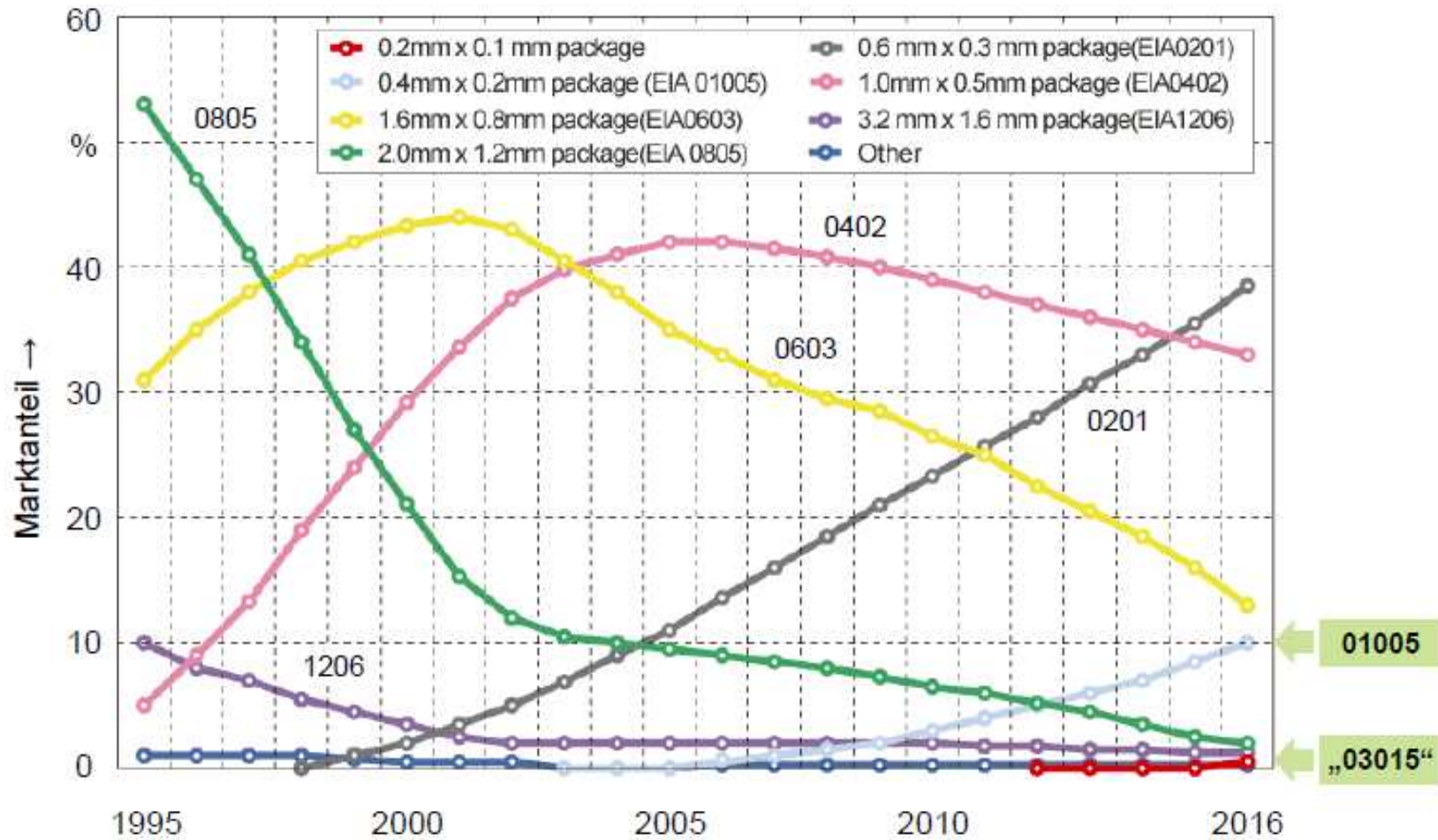
Typische Baugruppe im Jahr 2018.
Beidseitig reflow gelötete SMD-
Bestückung, zusätzliche selektiv gelötete
THT-Bauteile tausende von Lötstellen -
viele davon versteckt unter Bauteilkörpern
oder Schirmblechen.



Die Herausforderung:

- Anforderungen an die Funktionalität steigen stetig
- Die Zahl elektronischer Bauteile nimmt zu.
- Der verfügbare Platz für Bauteile wird immer kleiner.
- Die Dichte elektronischer Bauteile nimmt zu.
- Die Größe elektrischer Bauteile nimmt ab.
- Die Zahl von Bauteilen mit verdeckten Lötstellen nimmt kontinuierlich zu. (BGA, CSP, QFN, MLF...).

Herausforderung Miniaturisierung



Quelle: Murata Manufacturing Company, Ltd.

Herausforderung Miniaturisierung



Bauteiltypen: 0305 0201 01005 03015(metrisch)

Quelle: MuRata

Herausforderung Miniaturisierung

60 Our broad range of discrete packages provides maximum flexibility

	Ultra small	Very small	Small	Medium power
2 Pins	<p>DSN0603-2 (SOD962) 0.6 x 0.3 x 0.3 DFN1006D-2 (SOD882D) 1.0 x 0.6 x 0.37 DFN1006-2 (SOD882) 1.0 x 0.6 x 0.48 SOD523 1.2 x 0.5 x 0.4 DFN1608D-2 (SOD1608) 1.6 x 0.8 x 0.37</p>	<p>SOD323F 1.7 x 1.25 x 0.7 SOD323 1.7 x 1.25 x 0.95</p>	<p>SOD123F 2.6 x 1.4 x 1.1 SOD123W 2.6 x 1.7 x 1.0</p>	<p>SOD128 3.8 x 2.6 x 1.0</p>
3 Pins	<p>DFN1006B-3 (SOT883B) 1.0 x 0.6 x 0.37 DFN1006-3 (SOT883) 1.0 x 0.6 x 0.48 DFN1010D-3 (SOT1215) 1.1 x 1.0 x 0.37 SOT663 1.6 x 1.2 x 0.55 SOT416 1.6 x 0.8 x 0.77</p>	<p>SOT323 2.0 x 1.25 x 0.95 DFN2020-3 (SOT1851) 2.0 x 2.0 x 0.42</p>	<p>SOT23 2.9 x 1.5 x 1.0</p>	<p>SOT89 4.5 x 2.5 x 1.5 SOT428 6.6 x 6.1 x 2.3</p>
4/5 Pins	<p>WLCSP4* 0.76 x 0.76 x 0.61 DFN1010C-4 (SOT1194) 1.0 x 1.0 x 0.55 WLCSP5* 1.51 x 1.14 x 0.65 SOT665 1.6 x 1.2 x 0.55</p>	<p>SOT353 2.0 x 1.25 x 0.95</p>	<p>SOT143B 2.9 x 1.3 x 1.0 SOT753 2.9 x 1.5 x 1.0</p>	<p>LFPK33 3.3 x 3.3 x 0.85 LFPK56 (Power SO8) 4.9 x 4.4 x 1.0 SOT223 6.3 x 3.5 x 1.65</p>
6 Pins	<p>DFN1010E-6 (SOT1202) 1.2 x 1.0 x 0.33 DFN1010B-6 (SOT1216) 1.0 x 1.0 x 0.37 DFN1010-6 (SOT991) 1.0 x 1.0 x 0.48 DFN1410-6 (SOT884) 1.45 x 1.0 x 0.48 WLCSP6* 1.6 x 1.15 x 0.65 SOT666 1.6 x 1.2 x 0.55</p>	<p>SOT363 2.0 x 1.25 x 0.95 DFN2020-6 (SOT1118) 2.0 x 2.0 x 0.42 DFN2020MD-6 (SOT1233) 2.0 x 2.0 x 0.62</p>	<p>SOT457 2.9 x 1.5 x 1.0</p>	<p>LFPK56D (SOT1205) 4.5 x 4.4 x 1.0</p>
8 Pins	<p>WLCSP9* 1.56 x 1.36 x 0.61 DFN1712-8 (SOT1157) 1.7 x 1.2 x 0.48 DFN1714U-8 (SOT983) 1.7 x 1.35 x 0.3</p>	<p>WLCSP16* 1.9 x 1.37 x 0.65 DFN2110-9 (SOT1178) 2.1 x 1.0 x 0.48 WLCSP24* 2.45 x 2.4 x 0.65</p>	<p>DFN2510A-10 (SOT1176) 2.5 x 1.0 x 0.48 DFN2520-9 (SOT1338) 2.5 x 2.0 x 0.48 DFN2512-12 (SOT1158) 2.5 x 1.2 x 0.48</p>	<p>SOT505 3.0 x 3.0 x 1.1 SOT552 3.0 x 3.0 x 1.1 DFN4020-14 (SOT1334) 4.0 x 2.0 x 0.48</p>

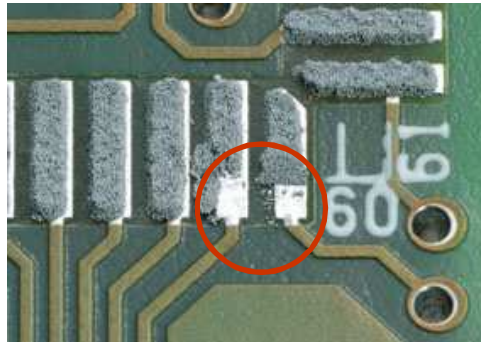
* The exact position of the balls and package dimensions vary
Document code number: 9367150113462

Quelle: http://www.nxp.com/documents/other/Discretess_package_poster.pdf

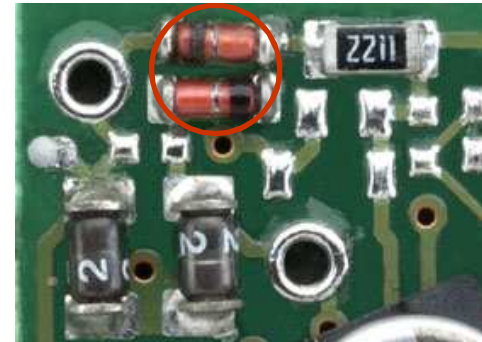
Die Herausforderung:

- Die Qualitätsanforderungen sind gestiegen
(von einstelligen ppm-Raten in Richtung Null Fehler)
- Stichprobenprüfung wird nicht mehr akzeptiert
- Rückverfolgbarkeit und Dokumentation des Produktlebenslaufs werden erwartet
- IPC A610 Class 3 wird als Qualitätsstandard vorausgesetzt
- Der Preisdruck reduziert Fertigungstaktzeiten
- Ein minimales Investitionsbudget steht der Forderung nach maximaler Produktionsleistung bei höchster Qualität gegenüber.

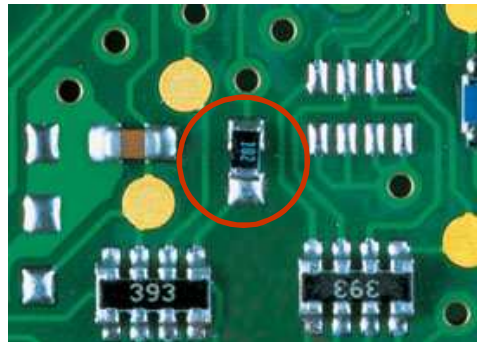
Fehler, die mit AOI detektierbar sind



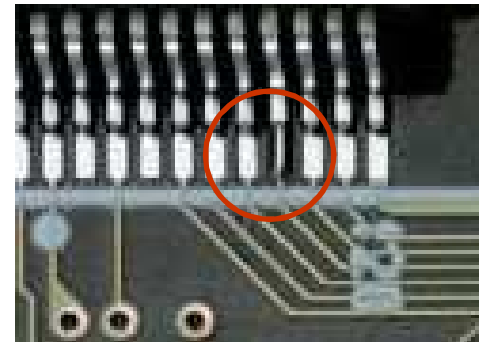
Pastendruck: fehlende oder verschmierte Lotpaste



Bestückung: Lage und Polarität der Bauteile



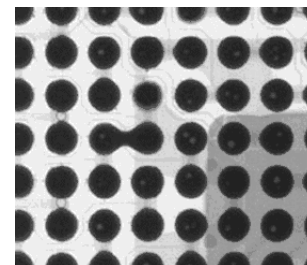
Post Reflow AOI orthogonal: Lötstellenausformung und z.B. Tombstone



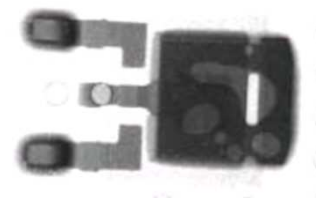
Post Reflow AOI geneigt: lifted Lead , Rückenlieger etc.

Fehlerarten, die Röntgen-Technik erfordern

■ Versteckte Lötstellen



■ Einschlüsse (Voids)

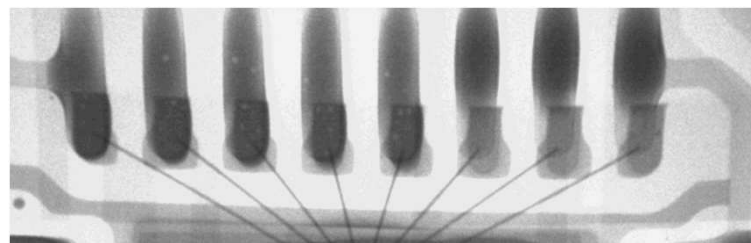


■ Der Füllgrad von THT-Anschlüssen

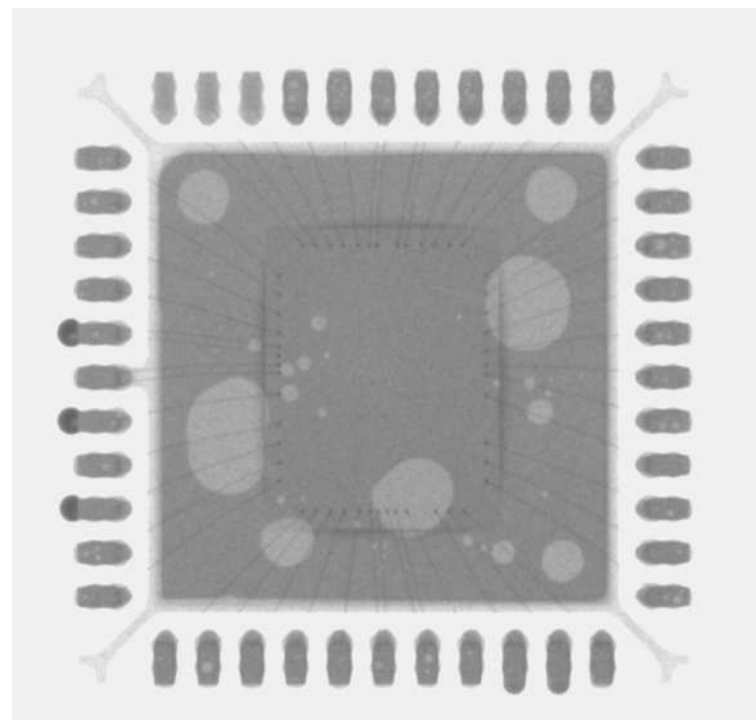
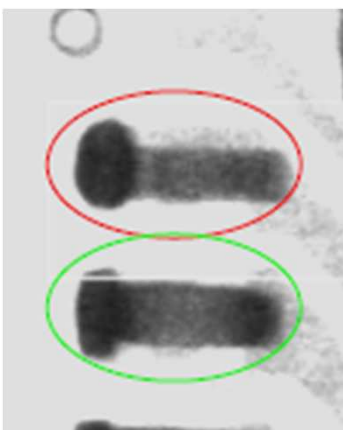


Fehlerarten, die Röntgen-Technik erfordern

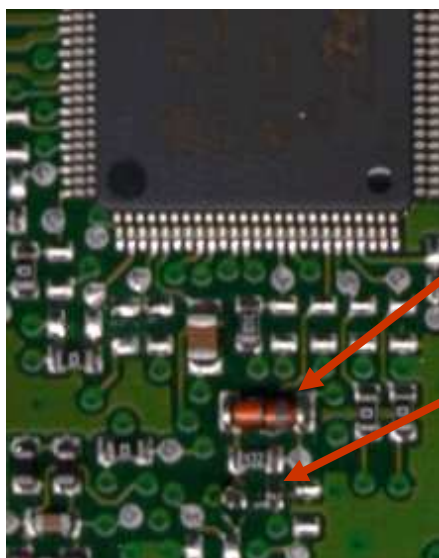
- QFN-Analyse (Quad Flat No Lead)



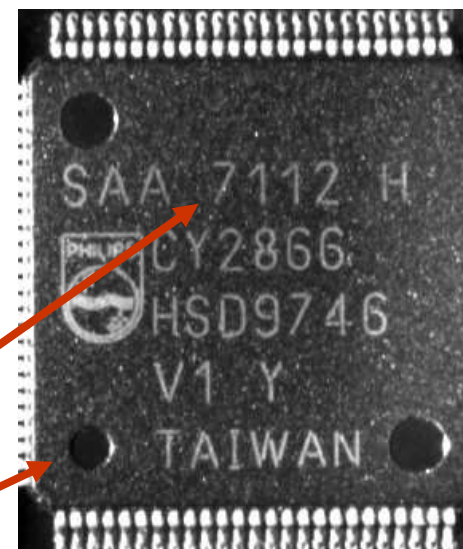
- Heal Meniskus Analyse bei J-Lead-Anschlüssen



Fehler, die mit Röntgentechnik *nicht* gefunden werden



Polarität,
Gehäuselage,
Rückenlieger,
farblich codierte
Bauteile



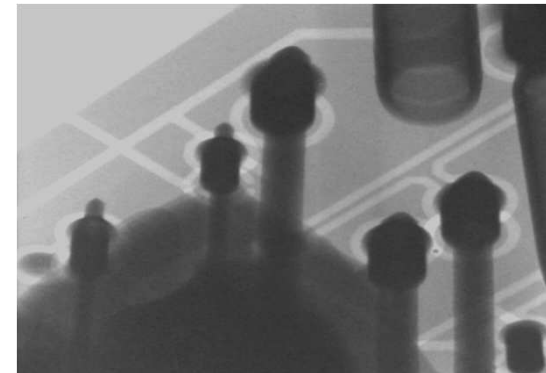
Text-Erkennung (Traceability)
Polungsmarken im Spritzguß

Lötstellen mit 2.5D Röntgen-Voraussetzung

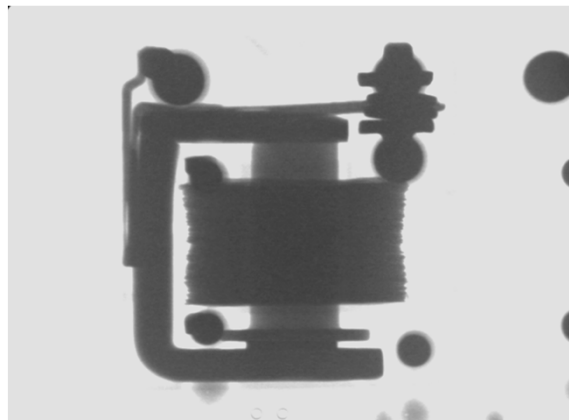
Füllgrad von THT-Lötstellen

Beispiel: Relais

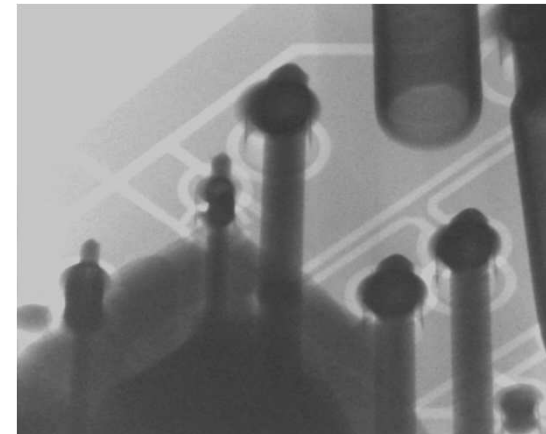
(mechanische Festigkeit der Lötstelle)



„Good“



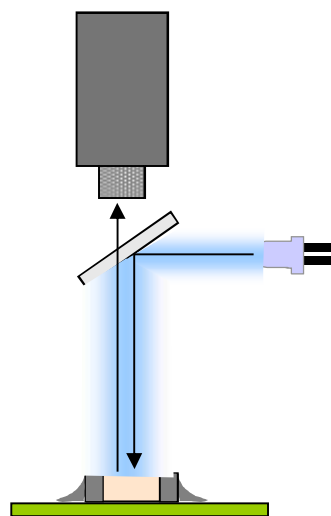
X-Ray Settings:
80 kV, 20 μ A



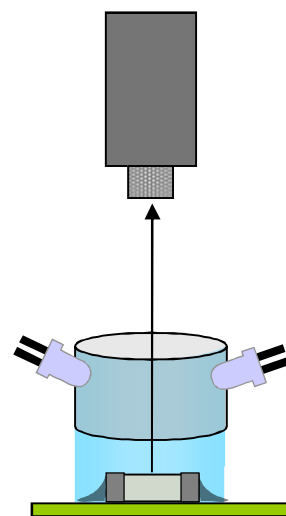
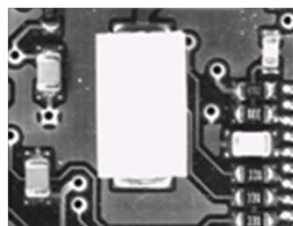
„Bad“

AOI: Verschiedene Beleuchtungsarten zur Fehlerfindung

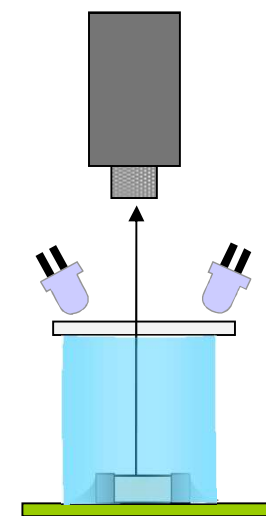
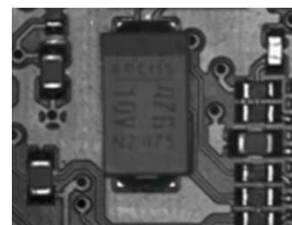
- Relevante Qualitätsmerkmale werden betont
- Störende Effekte werden eliminiert



Aufsicht – direkte Beleuchtung



Indirekte diffuse Beleuchtung

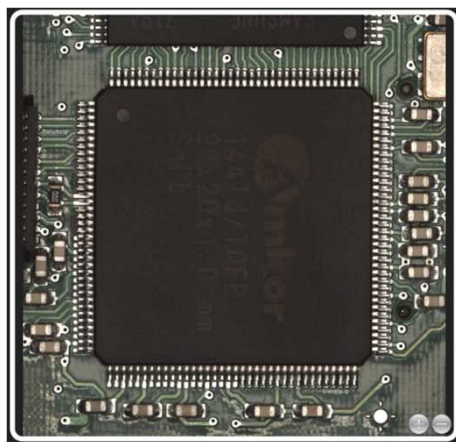


Engwinkelige diffuse Beleuchtung

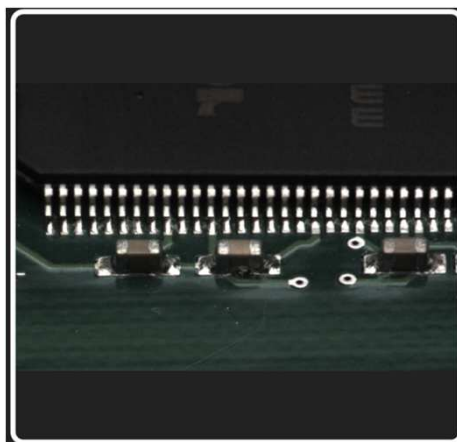


Geneigte Ansicht für höhere Prüfabdeckung

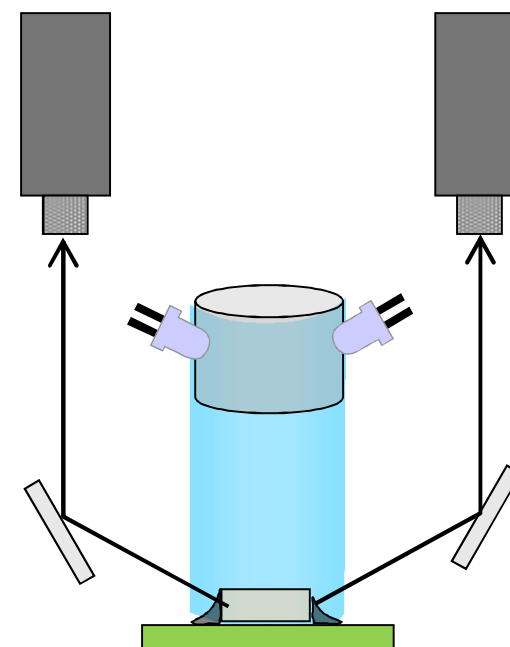
- Einsatz von 4 oder 8 Kameras, die über Spiegel umgelenkte Ansichten von der Lötstelle aufnehmen.
- 4 Kameras betrachten das Objekt aus Winkeln in 90° Schritten
- 8 Kameras erlauben den Blick aus Winkeln in 45° Schritten
- Für davon abweichende Bauteil-Drehlagen gibt es entsprechende Bildverarbeitungsalgorithmen.



orthogonale Ansicht

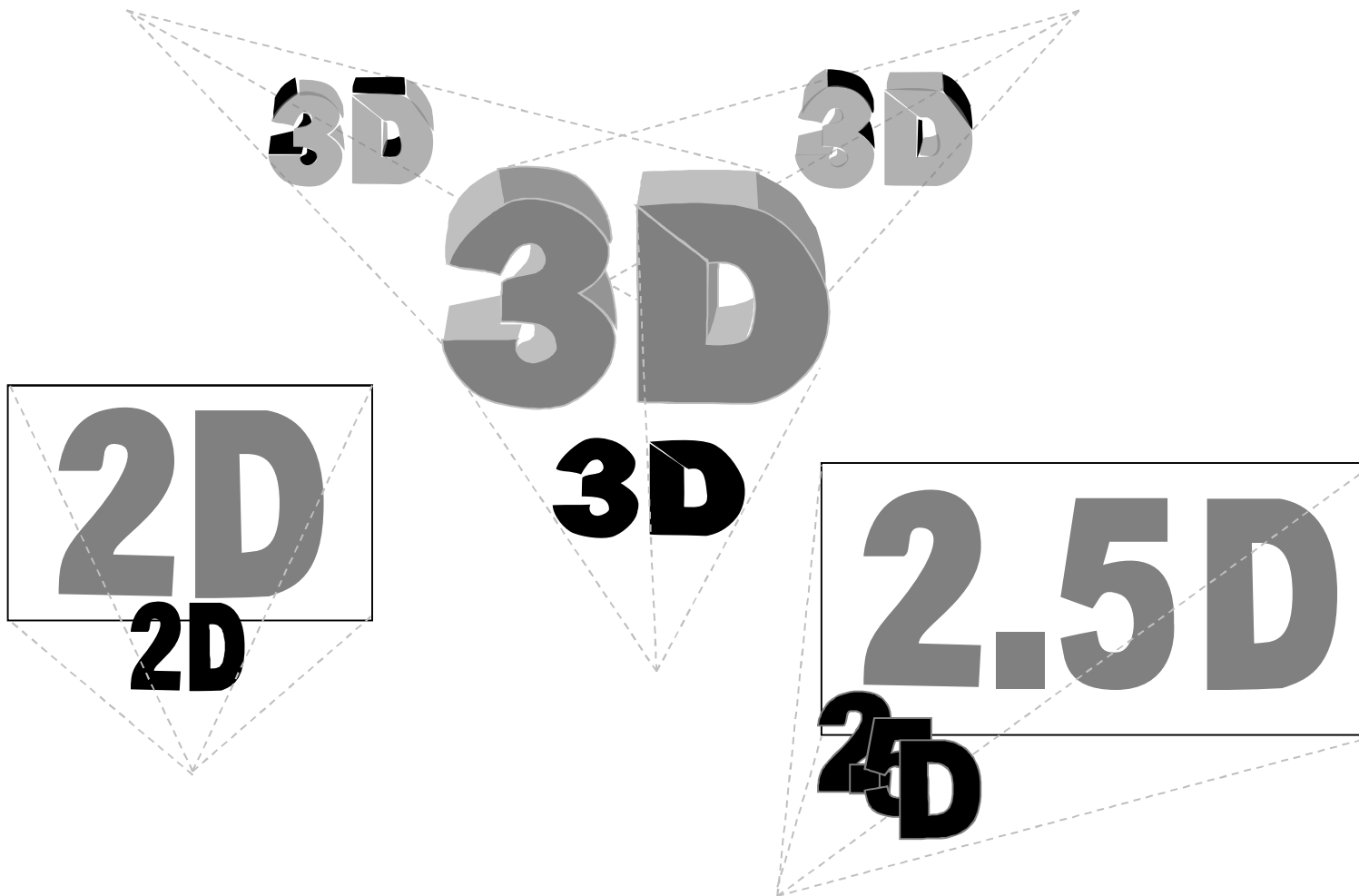


geneigte Ansicht



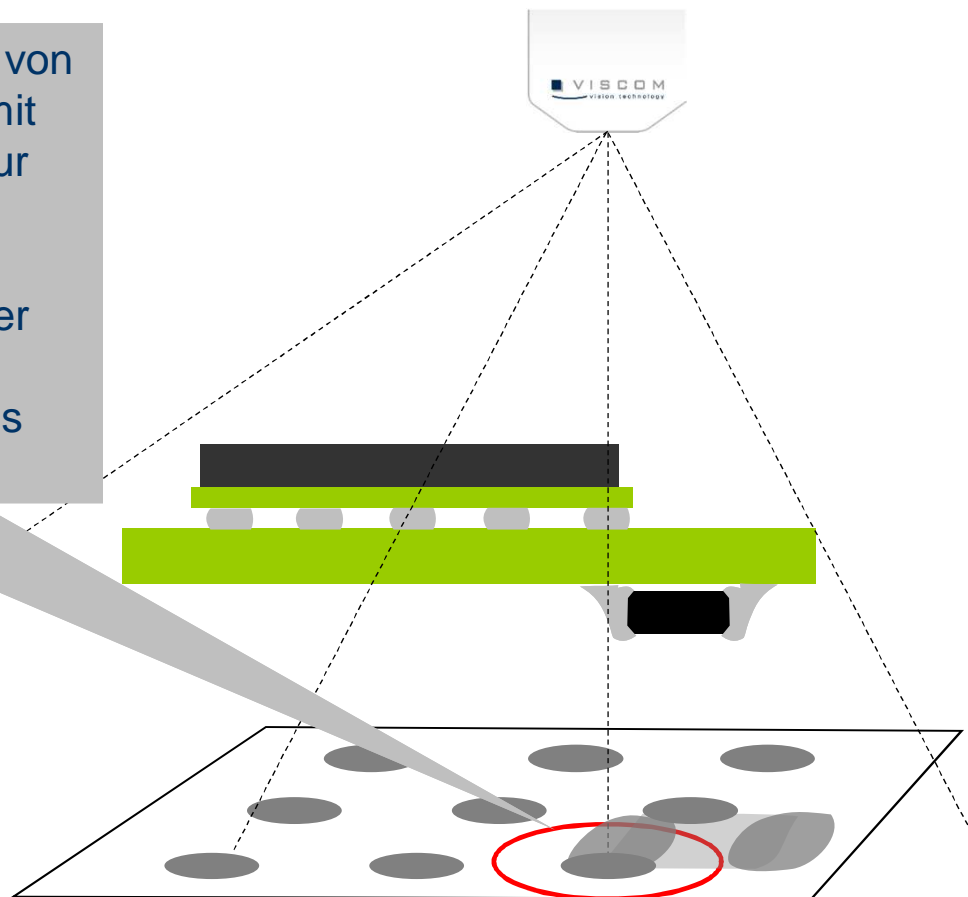
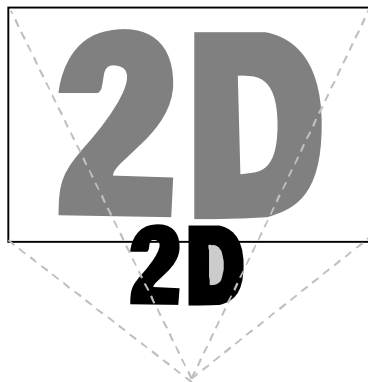
Röntgen

Methoden der automatischen Röntgeninspektion

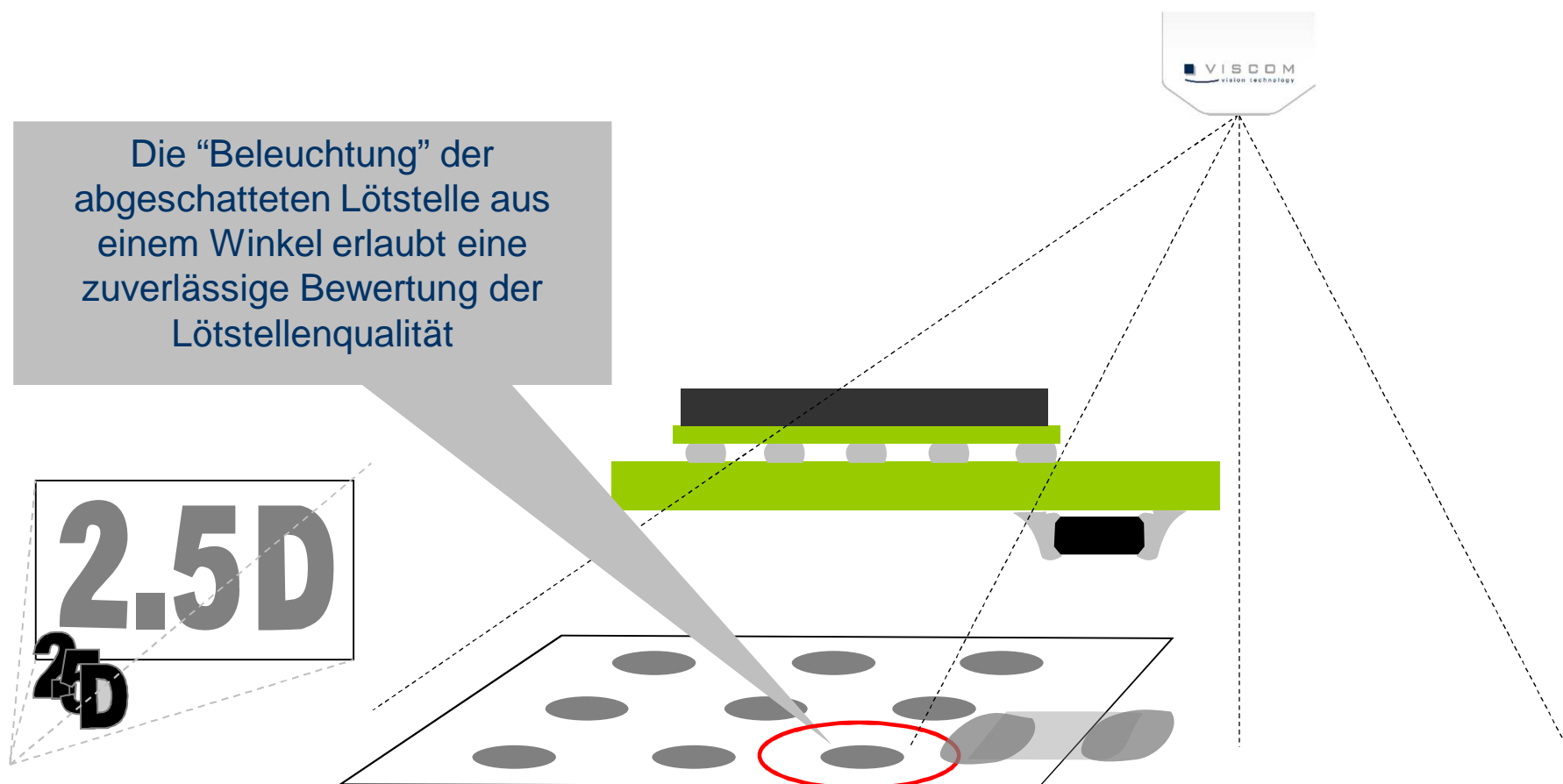


2D-Röntgeninspektion

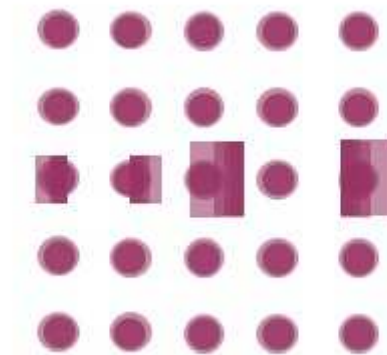
Beim 2D-Röntgen werden Bilder von der zu bewertenden Lötstelle mit einer Bestrahlung senkrecht zur Leiterplatte aufgenommen. Eine Abschattung durch absorbierendes Material auf der "anderen" Seite macht die Auswertung des Röntgenbildes schwierig.



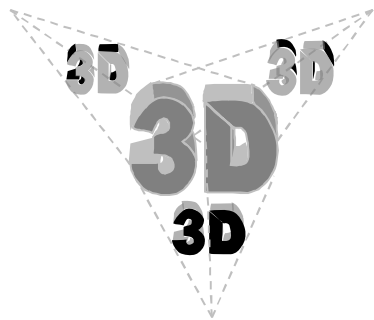
2,5D-Röntgen-Inspektion



3D-Röntgenanalyse: Tomosynthese



Klicke auf das BGA zum Starten der Animation



Gegenüberstellung: sichtbares Licht - Röntgenstrahlung

	Sichtbares Licht	Röntgen "Licht"
Anzahl gleichzeitig nutzbarer „Beleuchtungen“	viele	eine
Variationsgeschwindigkeit der „Beleuchtung“	schneller	langsamer
Bildaufnahme-Geschwindigkeit	schneller	langsamer
Wellenlängenspektrum (Bandbreite der Information)	breitbandig	schmalbandig
Informationsträger	Lichtreflexionen in verschiedene Richtungen	Schattenwurf in eine Richtung
Entfernung Quelle-Objekt-Sensor (Maschinenhöhe)	geringer	größer
Verfahrbereich zur vollen Prüfdeckung (Maschinen Grundfläche)	kleiner	größer
Resultierende Inspektionsleistung	größer	kleiner

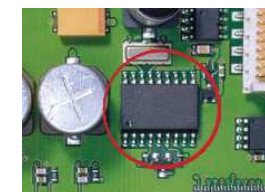
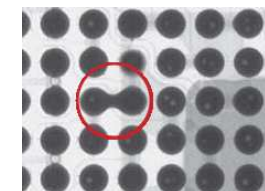
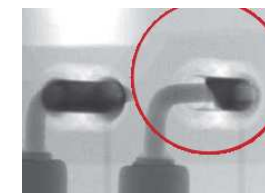
Die Stärken beider Technologien (AOI & AXI):

AXI:

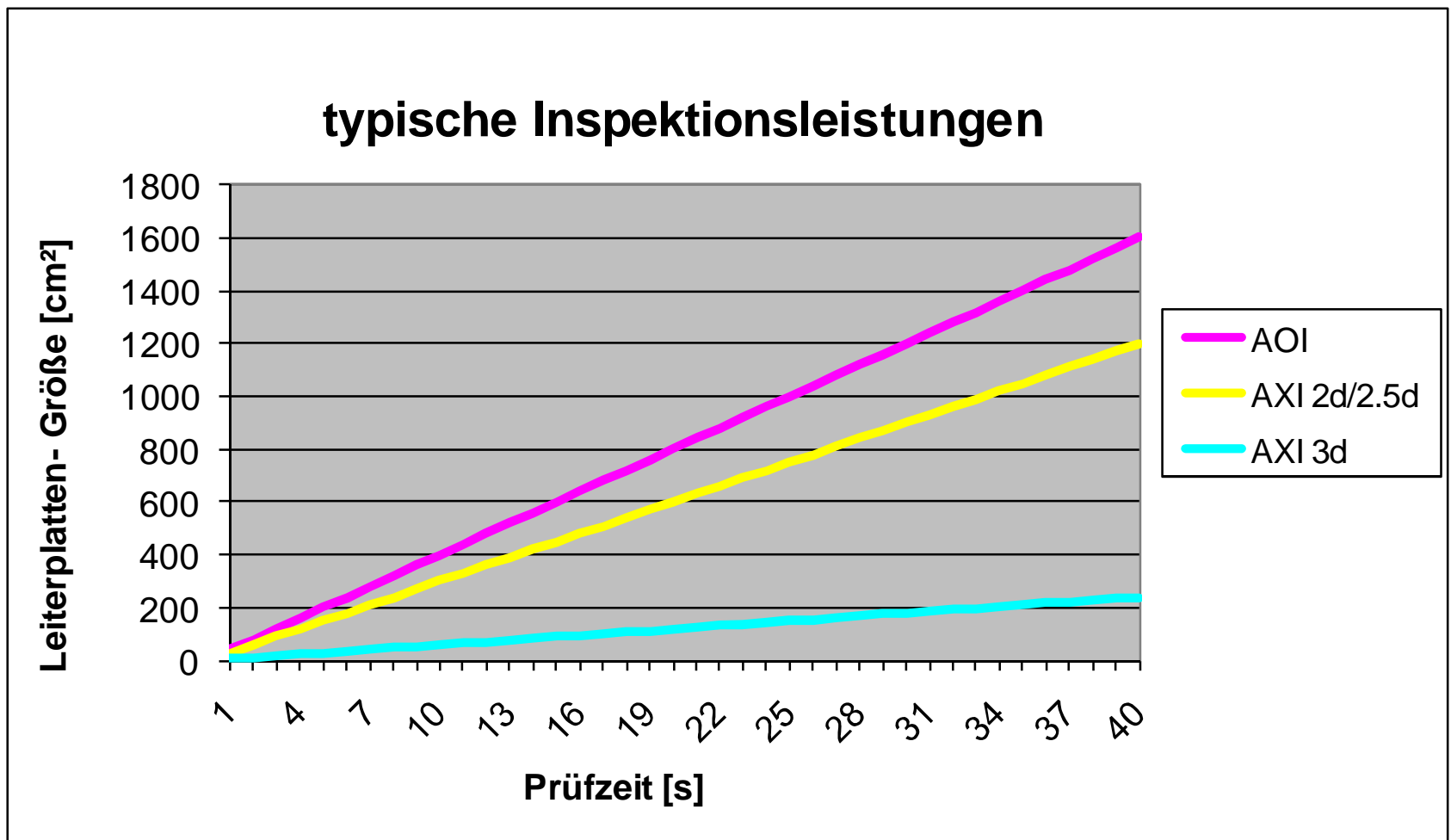
- Inspektion versteckter Lötstellen (BGAs, FlipChips, QFNs)
- Kurzschlusserkennung bei BGAs, FlipChips
- Lunker-Analyse (Wärmefallen, Masselötstellen)
- THT Lötstellenanalyse(Füllgrad/Lunker)
- QFP/SOIC Heel-Meniskus Analyse

AOI:

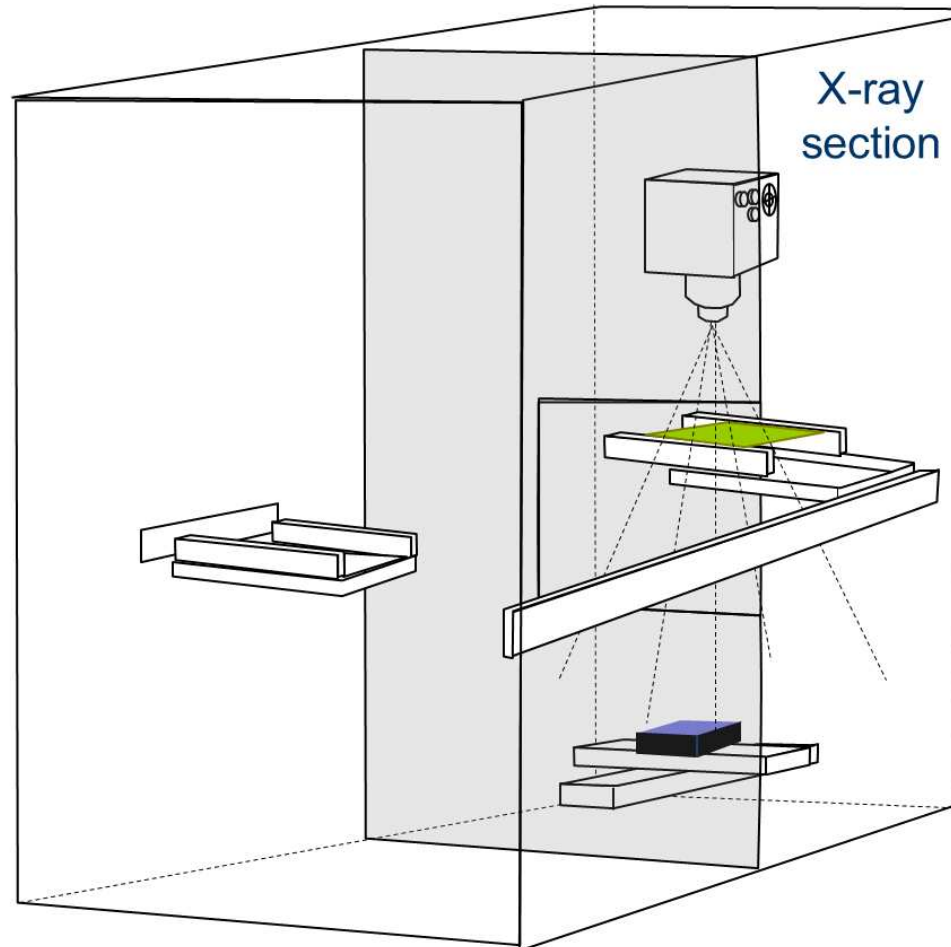
- Hohe Inspektionsgeschwindigkeit
- Merkmalsoptimierte Beleuchtungsarten
- Einfache Polungsanalyse
- OCR und DMC Lesen
- Präzise Lagekontrolle (X/Y/Winkel)
- Erkennung von Widerstand-Rückenliegern
- Analysierbarkeit von Oberflächenmerkmalen.



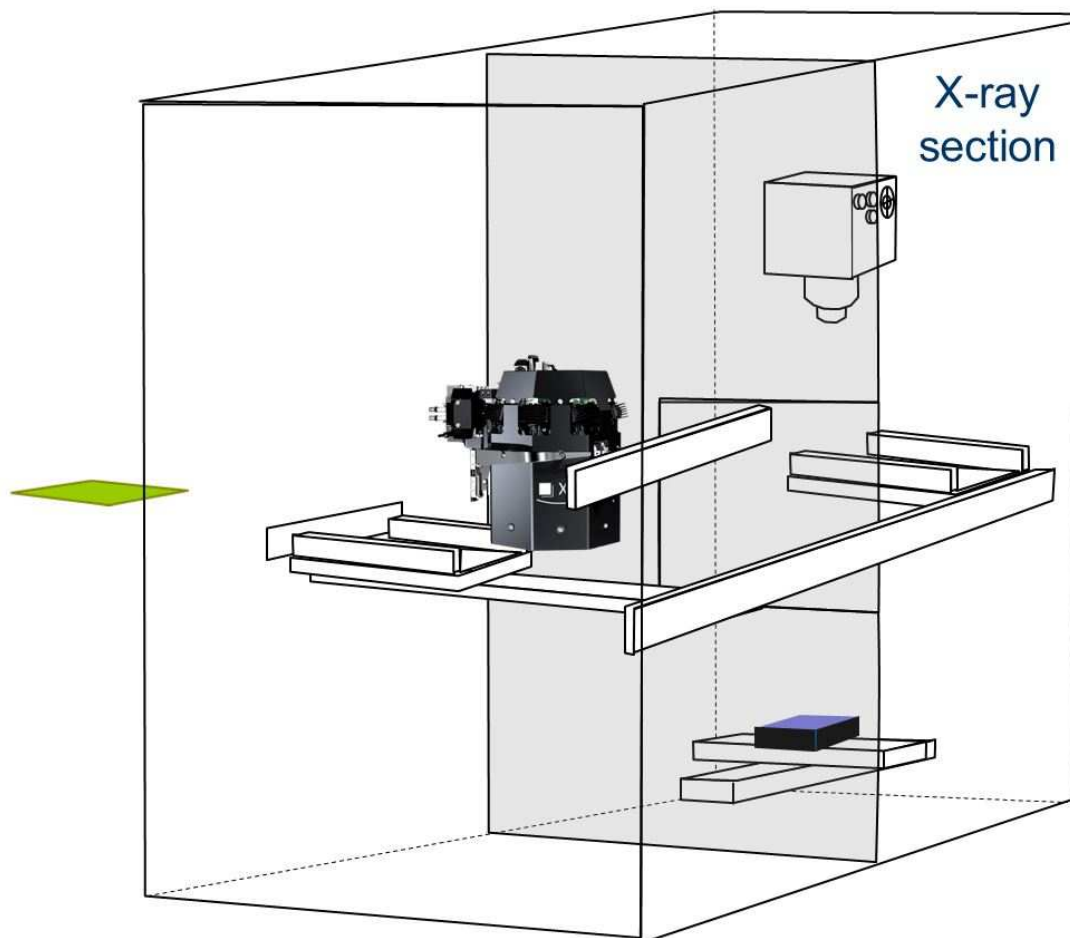
Inspektionsleistung AOI/AXI



Viscom X7056 RS AXI (X-Ray only)



Viscom X7056 RS Kombi-Inspektion AOI/AXI



Manuelles / Semi-Automatisches Röntgen / MXI

Labor-Röntgensysteme (Labor= lateinisch Arbeit)



X8011-II PCB und X8068

Zwei Maschinen-Plattformen – eine Technologie-Plattform!

X8011-II PCB (eco / plus / flex):

- Eco: 3-Achs-Manipulator mit Inspektionstisch, 5,7“ x 4,6“ FPD (14Bit)
- Plus: 3-Achs-Manipulator plus Drehteller plus Detektor-Schwenkachse, 5,7“ x 4,6“ FPD (14Bit)
- Flex: 3-Achs-Manipulator plus Drehteller plus Detektor-Schwenkachse, 8“ x 8“ FPD (14/16Bit)
- Manuell oder automatisch zu öffnendes Beladefenster
- Prüfbereich: 325mm x 460mm (Tisch) bzw. 320mm x 320mm (Drehteller)
- Max. Probengewicht: 10kg (Tisch) / 5kg (Drehteller)
- Abmessungen 1154mm x 2006mm x 1507mm (BxHxT)

X8068:

- 3-Achs-Manipulator plus Drehteller plus Detektor-Schwenkachse, 5,7“ x 4,6“ FPD (14Bit)
- Manuell oder automatisch zu öffnendes Beladefenster
- Prüfbereich: Durchmesser 722mm (geeignet z.B. für 60mm x 400mm)
- Max. Probengewicht: 15kg
- Abmessungen 1859mm x 2202mm x 2155mm (BxHxT)

X8011-II PCB und X8068

Zwei Maschinen-Plattformen – eine Technologie-Plattform!

Röhrentechnik:

- Viscom XT9160T-ED (offene Ganzmetall-Röhre), bis zu 160kV/40W, (geometrische) Vergrößerung bis zu 2.500fach
- XT9130 (geschlossene Direktionalstrahler-Röhre, wartungsfrei), bis zu 130kV/40W, (geometrische) Vergrößerung bis zu 35fach

Bildwandler:

- Flachbild-Detektor 5,7“ x 4,6“, 14Bit, CMOS-Technologie
- Flachbild-Detektor 8“ x 8“, 14/16Bit, aSi-Technologie

Schwenkachse für Detektor: 0...60°

Bediensoftware XMC, optional zusätzlich SI

Optional Verifikationsplatz Haran „on-board“ oder separat

Traceability möglich über internen BC/DMC-Scanner, optional zusätzlicher Handscanner

X8011 Rotations- und Schwenk-Achsmodule

X8011-II PCB: einfaches Anpassen des Manipulators („EasyClick“)



Rechtecktisch-Modul



Drehtisch-Modul



Dreh-/Kipp-Achsmodule



Hochgenaue Drehachse
für CT-Anwendungen



Detektor-Schwenkachse

X8011-II PCB und X8068

X8011-II PCB: Rotatorische CT („XVR-CT“)

Ermöglicht Rekonstruktion der inneren Volumenstruktur

Typische Anwendungsbereiche:

- Prototypentest (Fertigung, Verschleiß, ...)
- Fehlersuche bei Feldrückläufern
- Reverse Engineering

Typisch 180/360/720 Bildaufnahmen der rotierenden Prüfobjektes

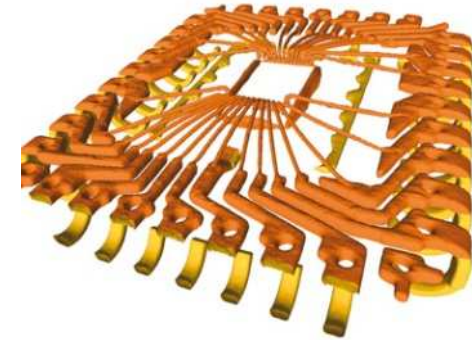
Auflösung bis in den Mikrometer-Bereich möglich

Direkte Strukturvermessung in realen Maßeinheiten

Erfordert optionale CT-Achse und Softwarepaket XVR-CT

Option „XVR CT“ verfügbar für alle X8011-II PCB Varianten

Jederzeit nachrüstbar



Planare CT möglich sowohl auf X8011-II PCB plus/flex als auch X8068 (mittels XVR-CT oder SI!)

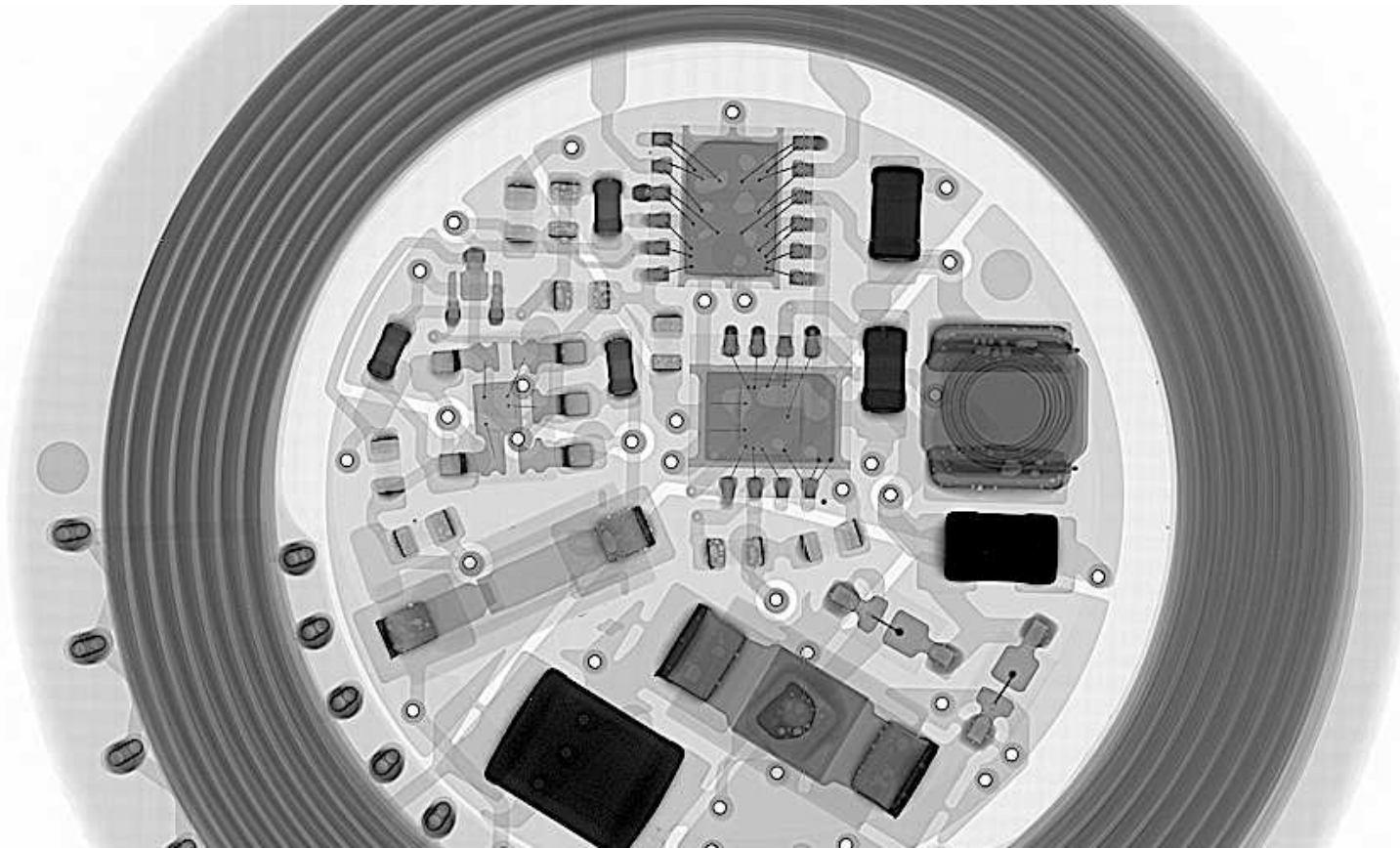
Prüfmuster - Übersicht

Röntgenuntersuchung für die Wittenstein electronics GmbH



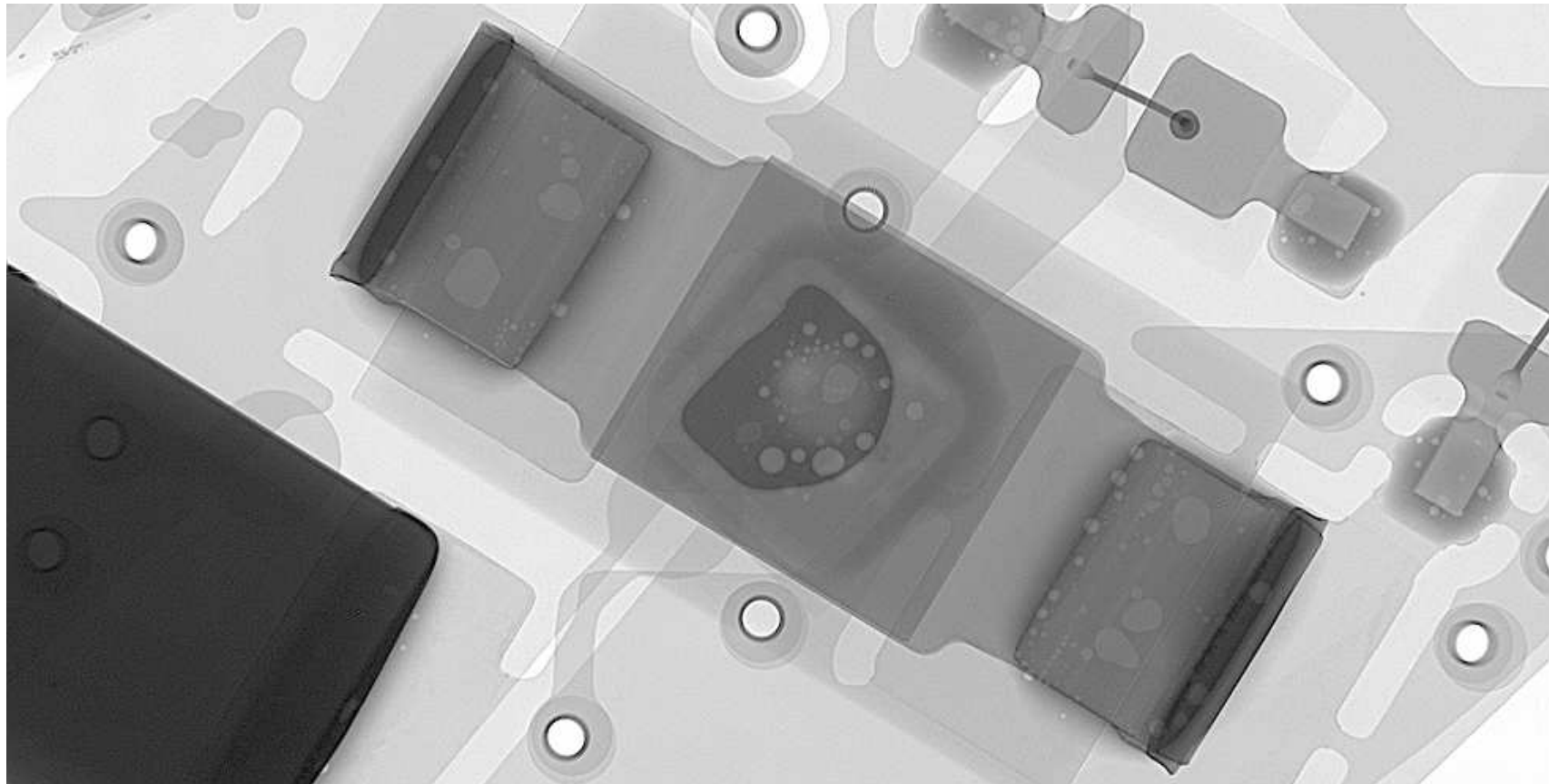
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



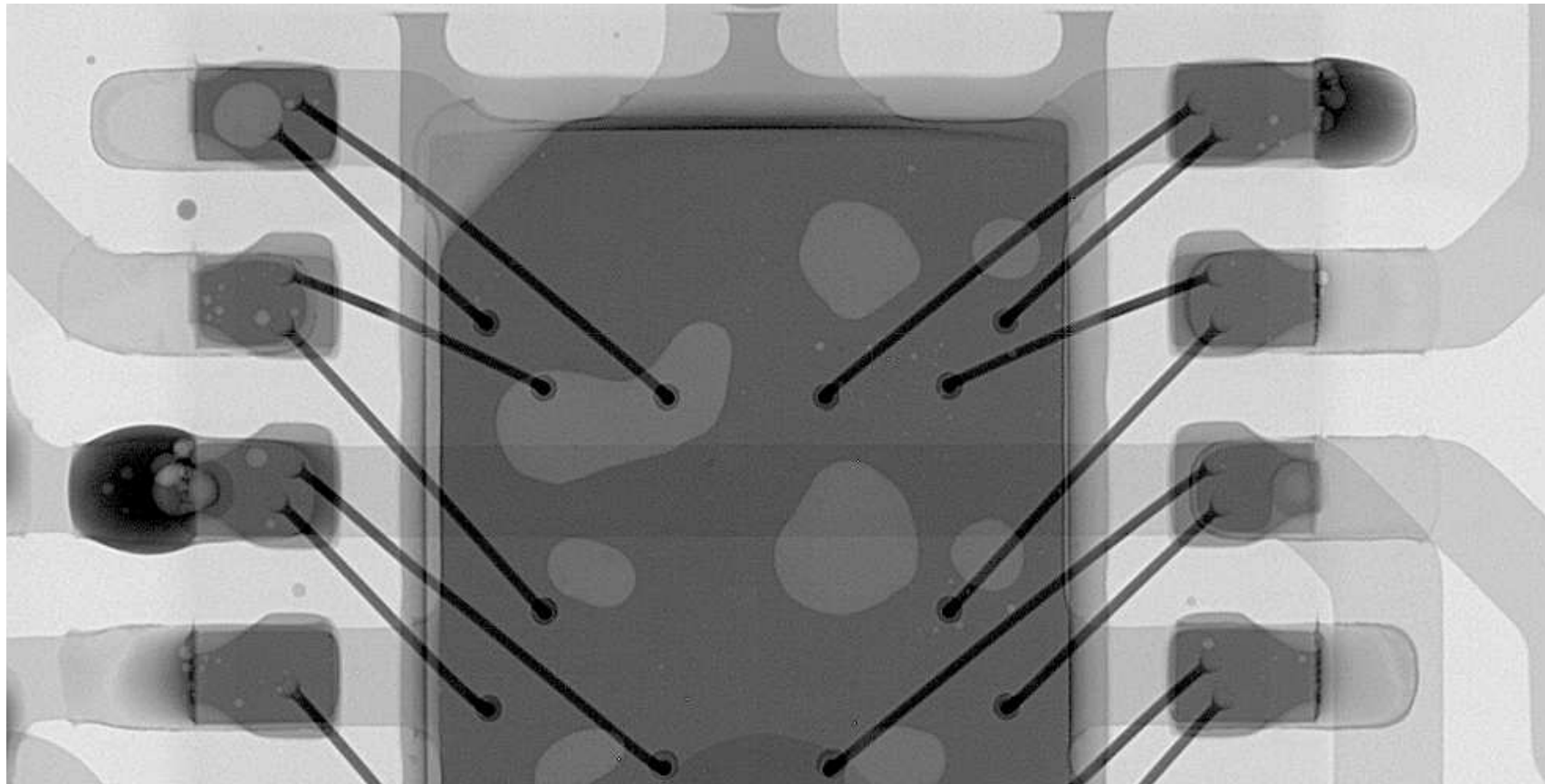
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



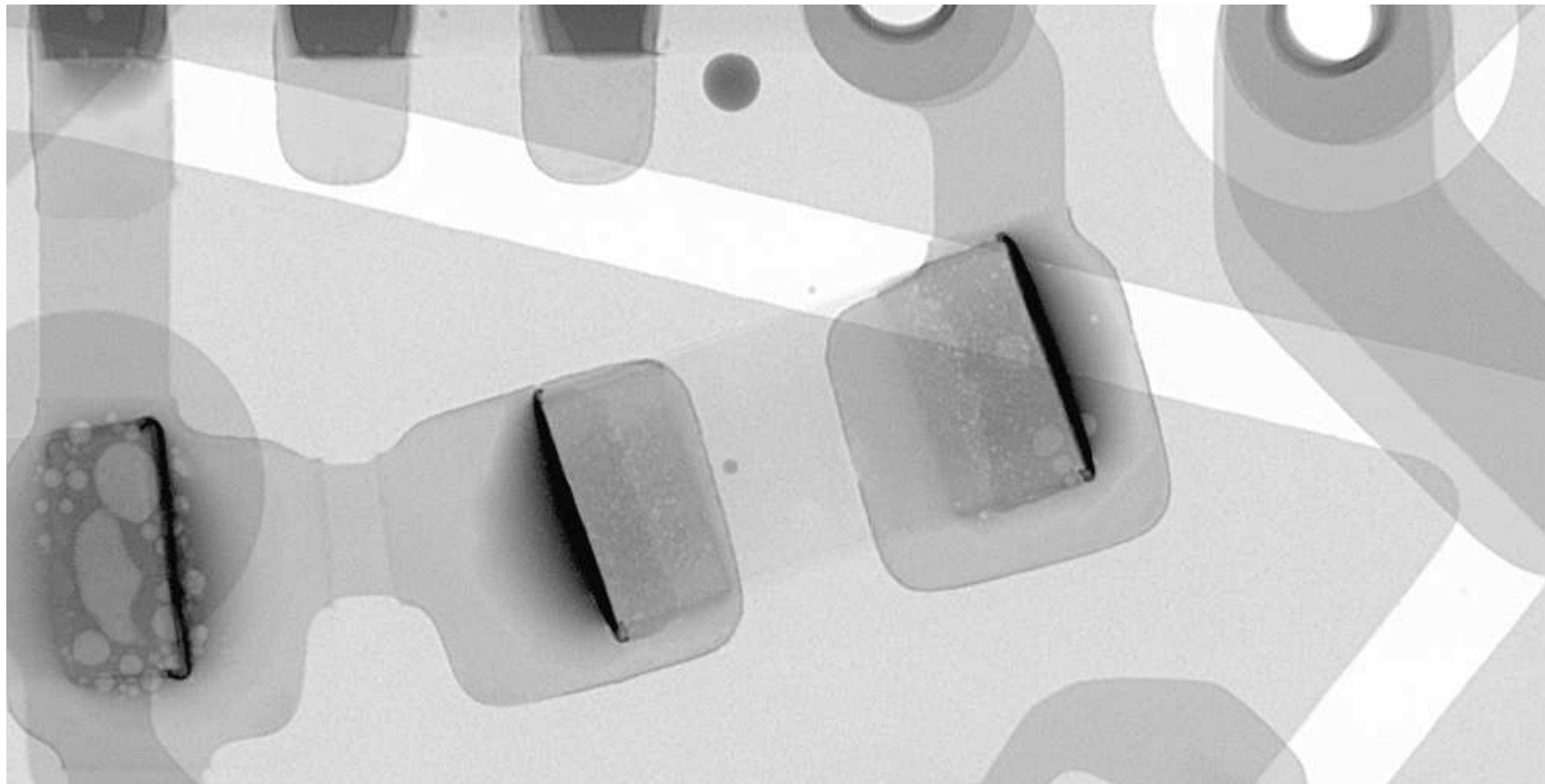
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



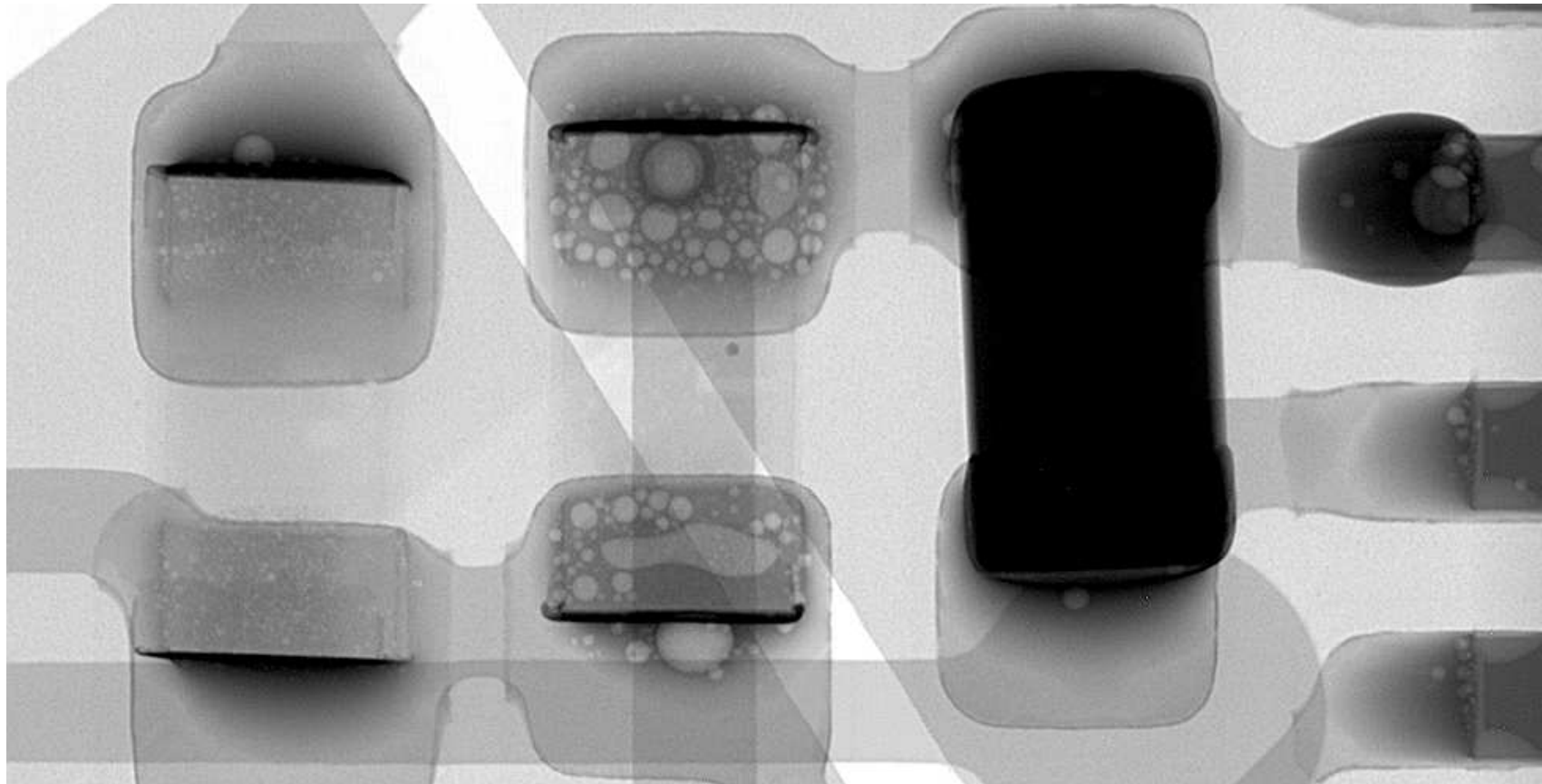
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



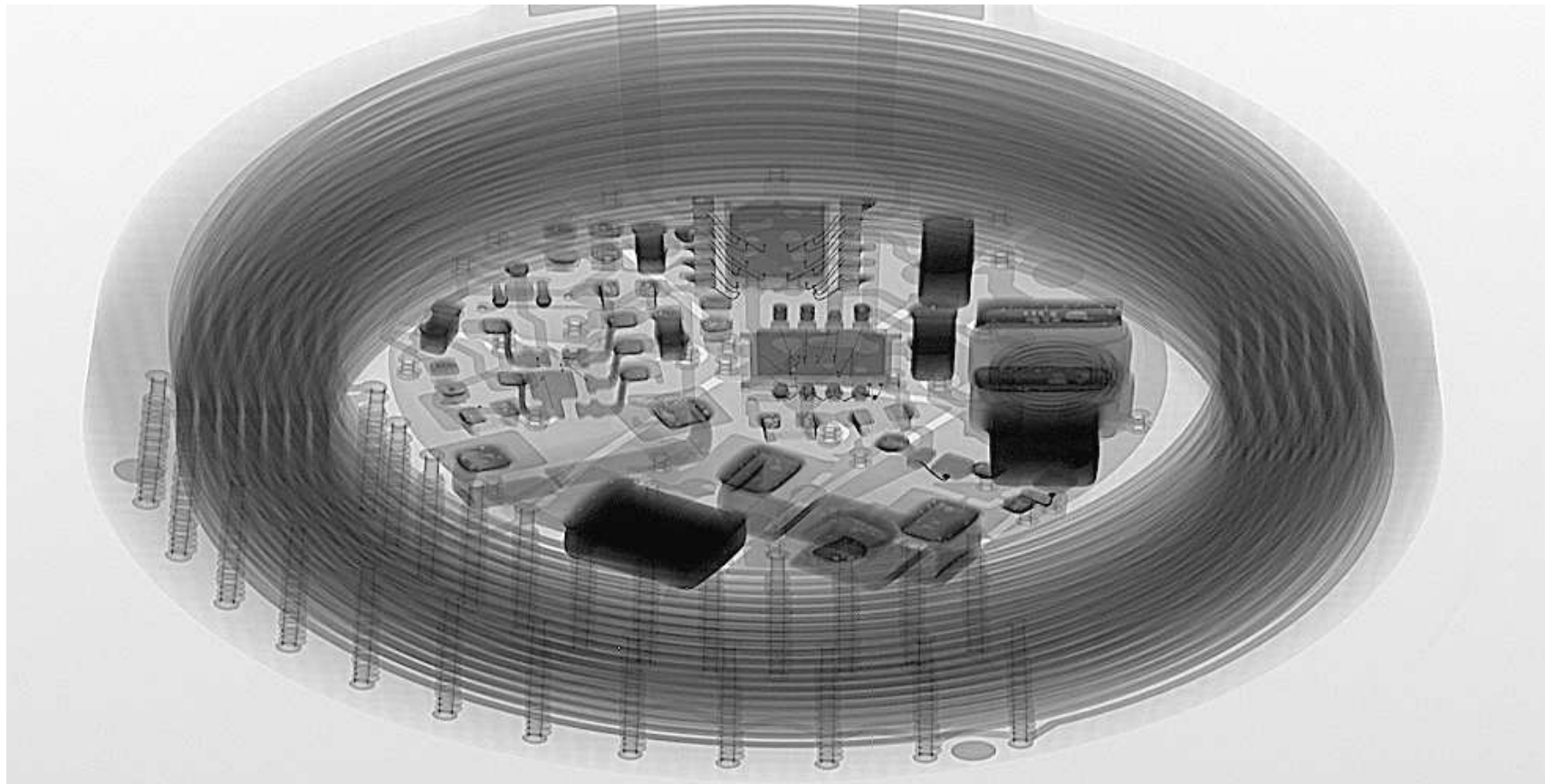
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



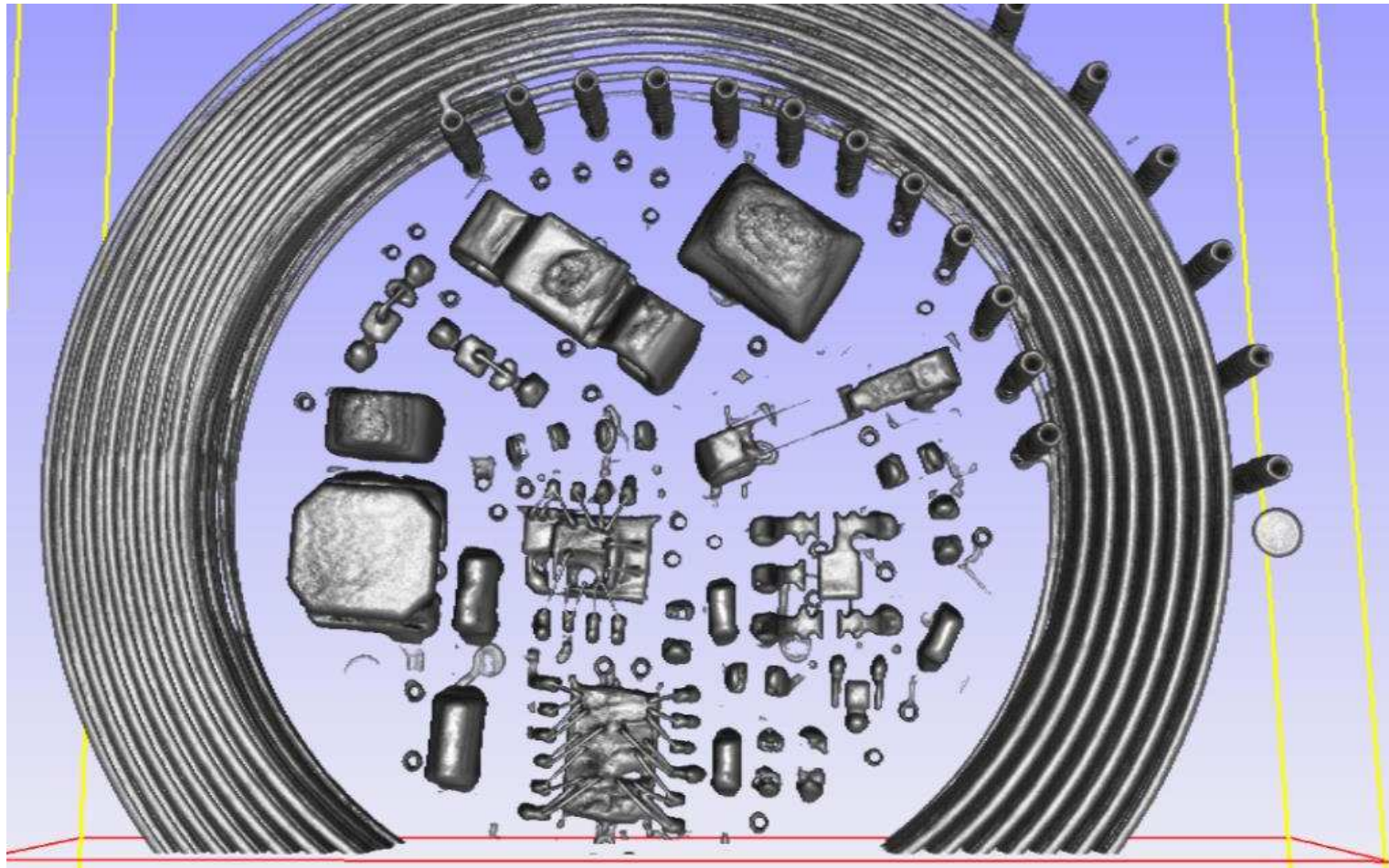
2D-Mikrofokus-Röntgeninspektion

Röntgenaufnahme von oben



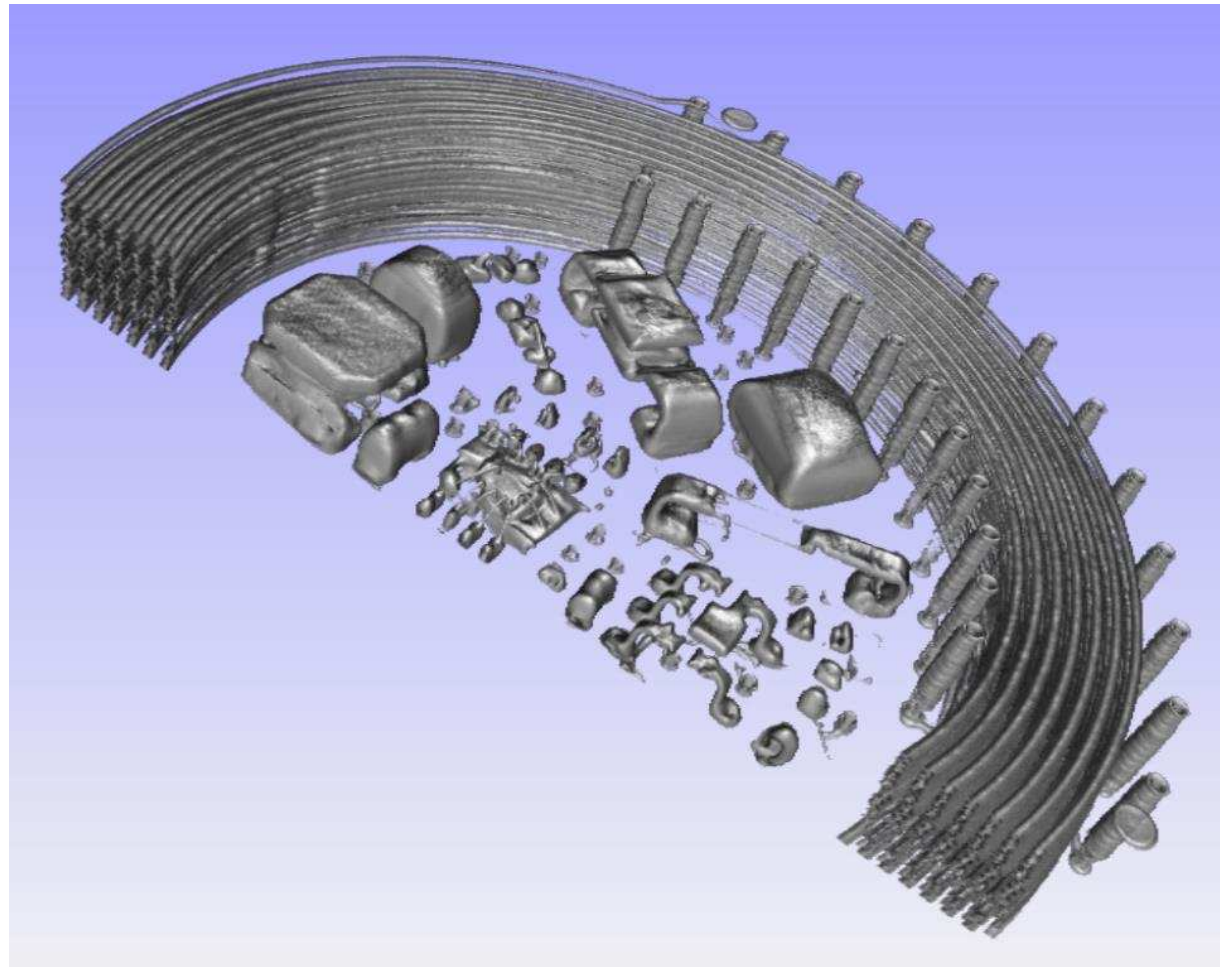
3D-Computertomographie

3D Rekonstruktionen aus der CT



3D-Computertomographie

3D Rekonstruktionen aus der CT



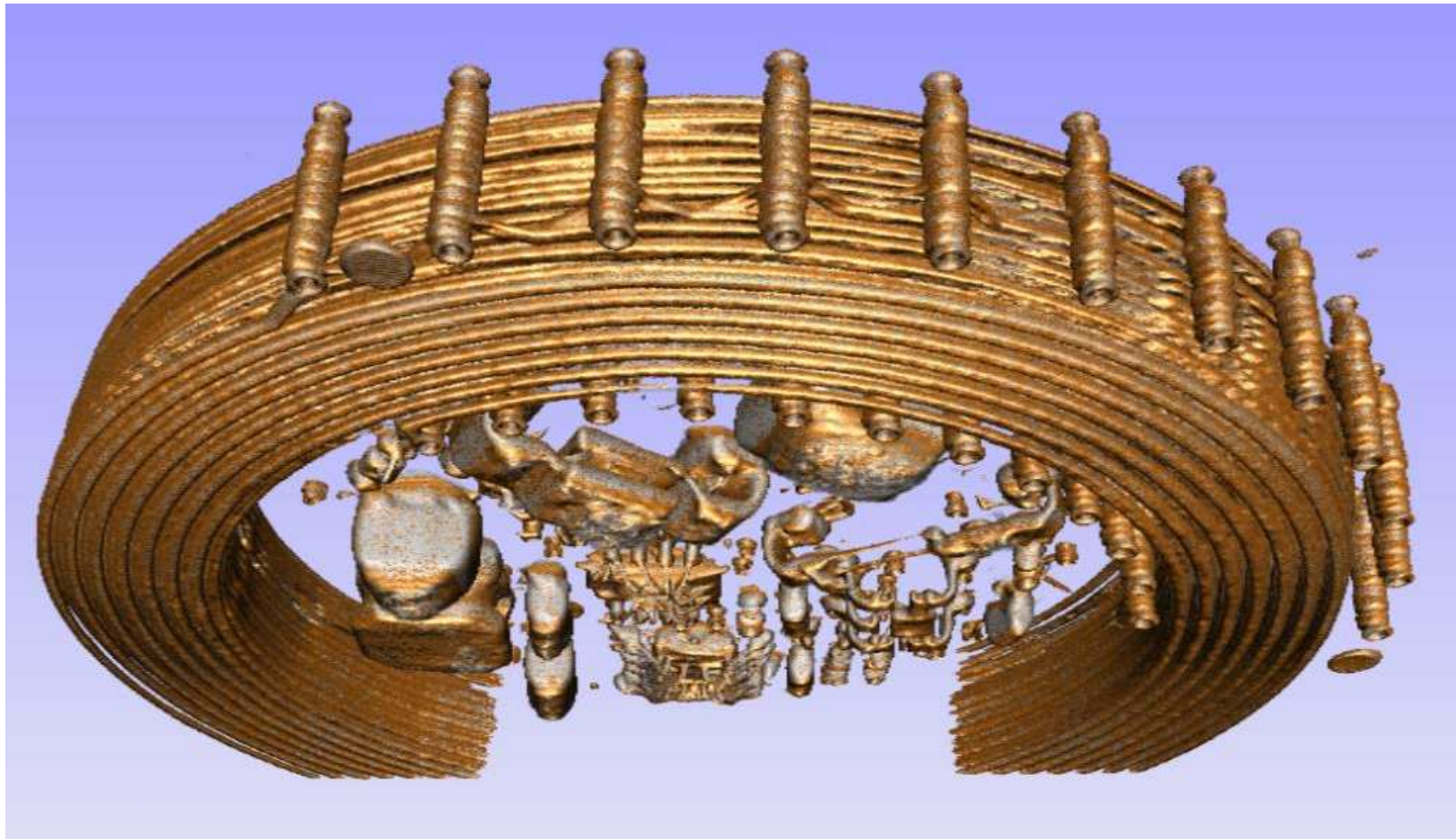
3D-Computertomographie

3D Rekonstruktionen aus der CT



3D-Computertomographie

3D Rekonstruktionen aus der CT



X8011PCB und X8068

Typischer Bedienzyklus:

Einlegen des Prüflings in die Maschine

Start des Systems – Fenster schließt

Strahlung wird eingeschaltet

Scannen / erste Prüfposition wird angefahren

- Prüfung rein manuell
- Prüfung mittels Positionsliste und manueller Klassifikation
- Vollautomatischer Prüfzyklus

Prüfzyklus beendet – Strahlung wird ausgeschaltet

Prüfergebnis wird angezeigt

Tisch fährt in Entladeposition – Fenster öffnet

Entnahme des Prüflings und Ablage unter Gut / Schlecht, ggf. Nachklassifikation

X8011PCB und X8068

Möglichkeiten im manuellen Betrieb:

Manuelle Bedienung / Inspektion:

- Die Steuerung des Systems obliegt vollständig dem Benutzer
- Das Verfahren des Manipulators ist frei möglich, die Bildaufnahmeparameter sind jederzeit verstellbar
- Bildmaterial kann abgespeichert werden, Vermessungstools angewendet werden, ...

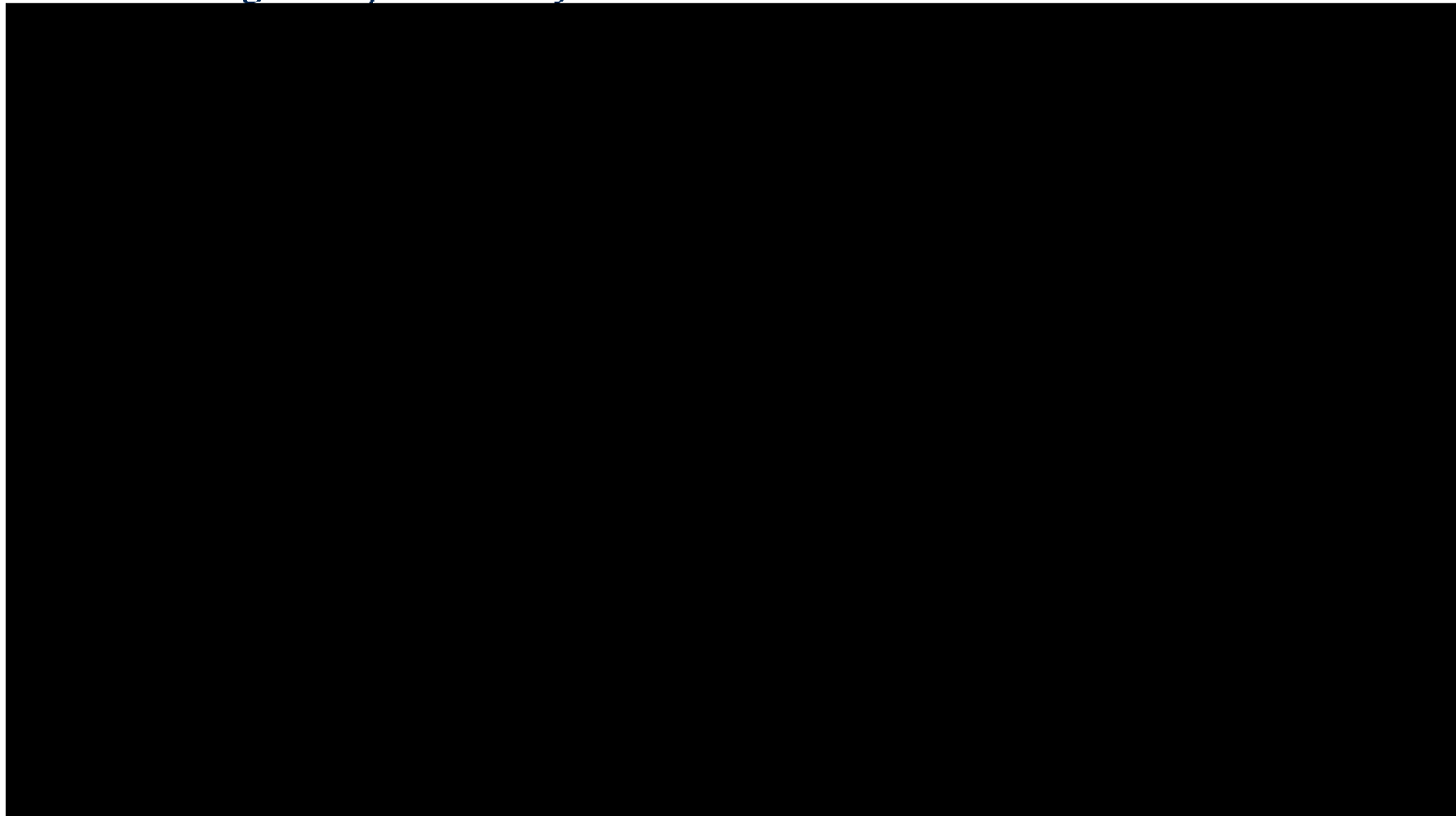
Positionsliste und manuelle Inspektion:

- Auf dem System ist ein Programm mit n anzufahrenden Positionen/Bildaufnahmen hinterlegt
- Sobald eine Position angefahren wurde, erhält der Bediener die volle Kontrolle über Bildparameter und Manipulator, kann zusätzlich Livetools anwenden
- Die Bearbeitung einer Position wird abgeschlossen mit Auswahl „Gut“/„Schlecht“ für diesen Prüfschritt, danach fährt das System an die nächste Position, usw.
- Als erster Schritt kann das Scannen des BC/DMC eingefügt werden
- Innerhalb der Positionsliste können zusätzlich automatische Prüfschritte eingefügt werden

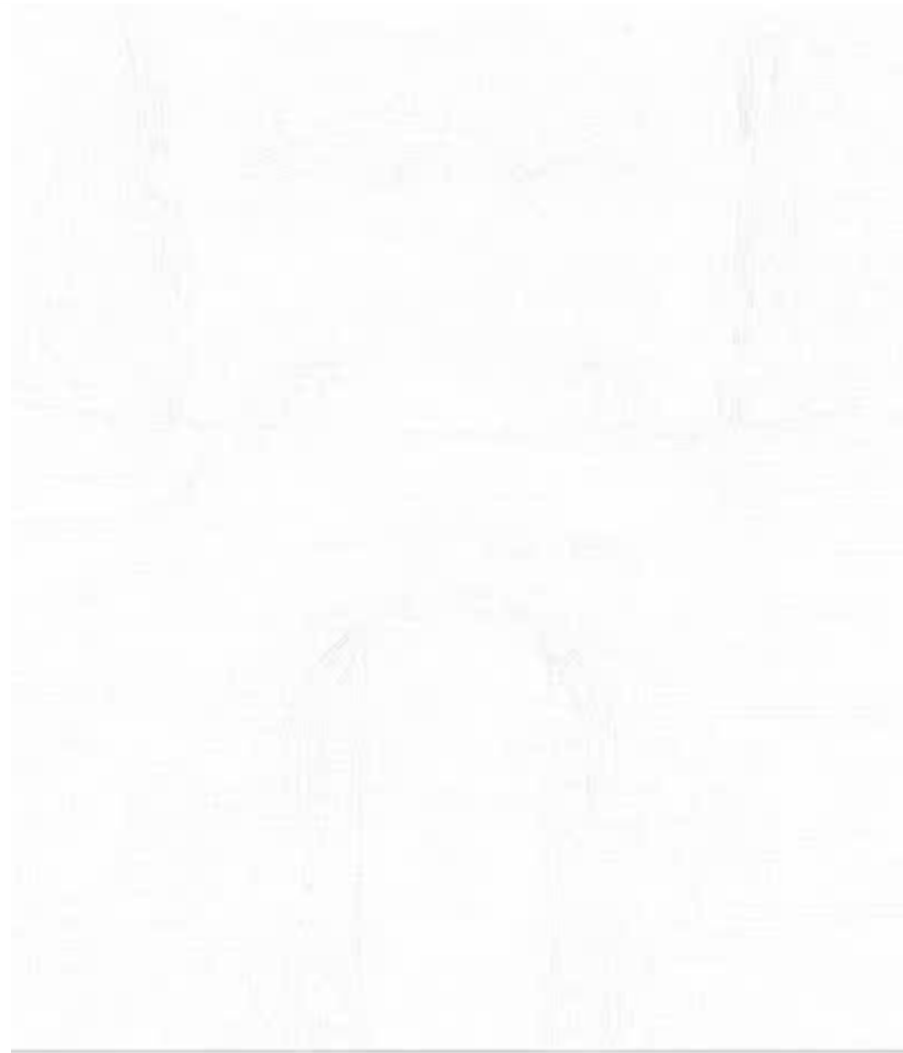
Labor-Röntgeninspektionssystem X8060



Labor-Röntgeninspektionssystem X8060







Empfehlungen zur Anwendung der Prüfmethoden

- Nutzen Sie so weit es geht die optische Inspektion, weil das die schnellste und zuverlässigste Inspektionsmethode ist. Die Fehlerbilder der Inspektionsergebnisse können von Sichtprüferinnen leicht verifiziert und klassifiziert werden.
- Setzen Sie 2D oder 2.5D Röntgen-Analyse für die Prüfung verdeckter Lötstellen ein, wenn Sie mit diesem Verfahren Lötstellen von anderem absorbierendem Material isolieren können. Hierfür ist nur eine Röntgenbildaufnahme nötig (schnelles Verfahren).
- Nutzen Sie die 3D Röntgenanalyse dann, wenn die beiden anderen Verfahren keine zuverlässigen Ergebnisse bringen (zeitaufwändigstes Verfahren)
- Ergebnisse der AOI-Prüfung können mit denen der Röntgenprüfung kombiniert und so ein Maximum an Prüfleistung und Prüftiefe bei minimaler Pseudofehlerrate erzielt werden.

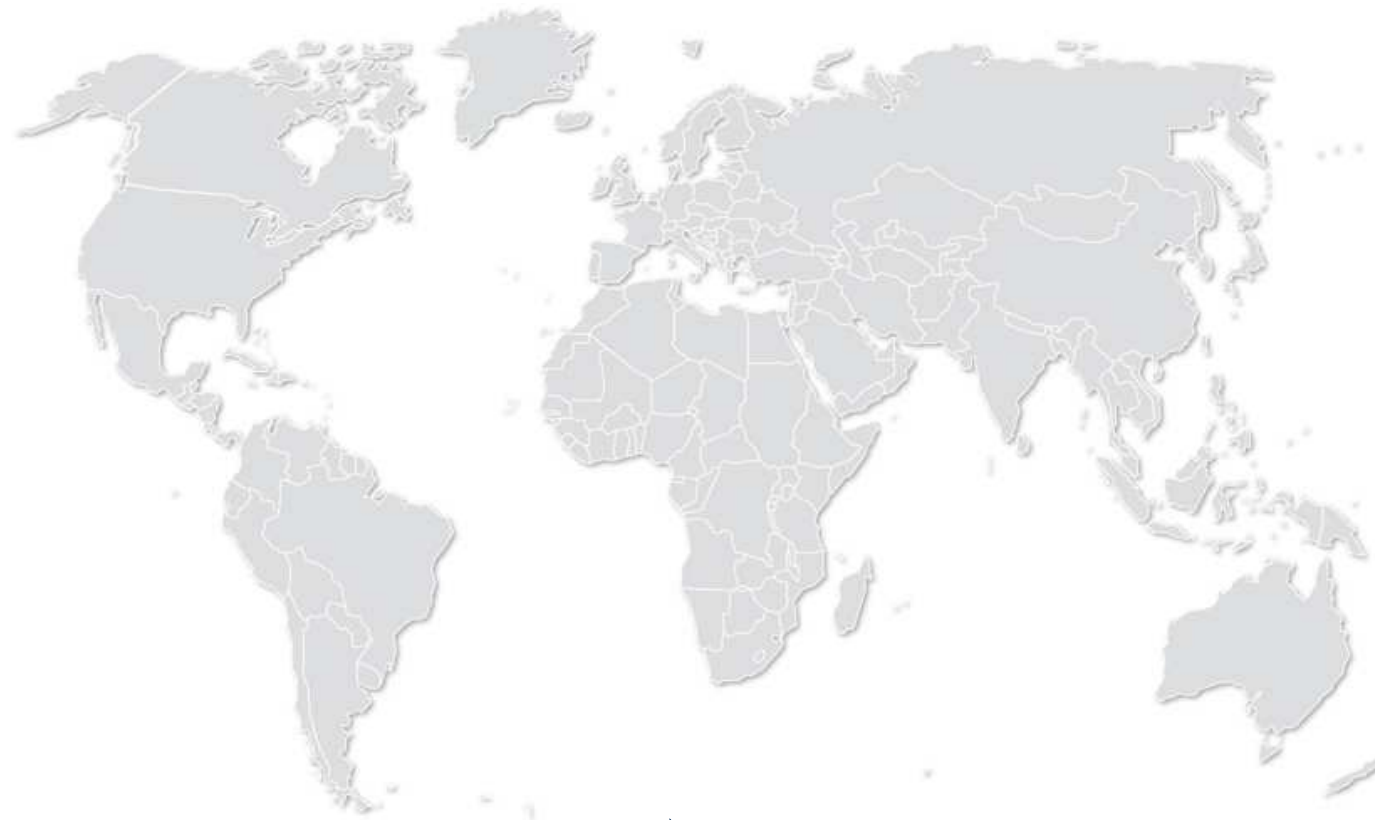
Zusammenfassung

Wenn Sie Ihre Ausfallraten von einstelligen ppm auf Null reduzieren müssen, dann sollten Sie sowohl die AOI- als auch die AXI- Technologie nutzen.

Wenn Sie weder den Platz noch das Budget für zwei Maschinen haben, dann sollten Sie sich ein kleines Kombi-Inspektionssystem anschaffen.

Wenn Sie einen Lieferanten suchen, der mehr als 25 Jahre Erfahrung mit AOI und über 15 Jahre Erfahrung mit AXI hat, dann sollten Sie sich an die Viscom AG in Hannover wenden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Zentrale:
Viscom AG
Carl-Buderus-Str. 9 - 15 · 30455 Hannover
Tel.: +49 511 94996-0 · Fax: +49 511 94996-900
info@viscom.de · www.viscom.de

► Unsere internationalen Niederlassungen und Repräsentanten in Europa, USA und Asien finden Sie unter:

www.viscom.com